

ユーザーズガイド

NEC NX7700xシリーズ

NX7700x/A3010E-2

1章 概 要

2章 準 備

3章 セットアップ

4章 付 錄

本製品のドキュメント

本製品のドキュメントは、次のように、冊子として添付されているもの(□)、EXPRESSBUILDER 内(○)に電子マニュアル(■)として格納されているものがあります。



安全にご利用いただくために

本機を安全に使うために注意すべきことを説明しています。**本機を取り扱う前に必ずお読みください。**



スタートアップガイド

本機の開梱から運用までを順を追って説明しています。はじめにこのガイドを参照して、本機の概要を把握してください。



EXPRESSBUILDER



ユーザーズガイド

1章 概要

本機の概要、各部の名称、および機能について説明しています。

2章 準備

オプションの増設、周辺機器との接続、および適切な設置場所について説明しています。

3章 セットアップ

システム BIOS の設定と EXPRESSBUILDER の概要について説明しています。

4章 付録

本機の仕様などを記載しています。



メンテナンスガイド

1章 保守

本機の保守とトラブルシューティングについて説明しています。

2章 便利な機能

便利な機能の紹介、システム BIOS、RAID コンフィグレーションユーティリティー、および EXPRESSBUILDER の詳細について説明しています。

3章 付録

エラーメッセージなどを記載しています。



その他のドキュメント

ESMPRO、Universal RAID Utility の操作方法など、詳細な情報を提供しています。

目 次

本製品のドキュメント	2
目 次	3
本書で使う表記	6
本文中の記号	6
「光ディスクドライブ」の表記	6
「ハードディスクドライブ」の表記	6
「リムーバブルメディア」の表記	6
オペレーティングシステムの表記(Linux)	7
「POST」の表記	7
「BMC」の表記	7
商 標	8
ライセンス通知	9
ライセンス文	9
本書についての注意、補足	11
最新版	11
安全にかかわる表示について	12
安全上のご注意	13
取り扱い上のご注意(正しくお使いいただくために)	14
取り扱い上のご注意(静電気対策について)	16
1章 概 要	18
1. はじめに	19
2. 付属品の確認	20
3. 特 長	21
3.1 フームウェアおよびソフトウェアのバージョン管理	24
4. 各部の名称と機能	25
4.1 前 面	25
4.2 前 面(フロントベゼルを取り外した状態)	26
4.3 背 面	27
4.4 外 観	28
4.5 内 部	29
4.6 マザーボード	30
4.7 ランプ表示	31
4.7.1 POWER ランプ (LED)	31
4.7.2 STATUS ランプ (LED)	32
4.7.3 LINK/ACT ランプ(古1、古2、古3、古4)	33
4.7.4 光ディスクアクセスランプ(オプション)	33
4.7.5 UID ランプ	33
4.7.6 Power Capping ランプ	34
4.7.7 ハードディスクドライブのランプ	34
4.7.8 LAN コネクタのランプ	35
4.7.9 電源ユニットの AC POWER ランプ	36

2章 準 備	37
1. 内蔵オプションの取り付け/取り外し	38
1.1 安全上の注意	38
1.2 静電気対策	39
1.3 取り付け／取り外しの概要	40
1.4 サーバーの確認(UID スイッチ)	42
1.5 フロントベゼルの取り外し	43
1.6 プロセッサー(CPU)	44
1.6.1 サポートする最大プロセッサー数	44
1.6.2 取り付け	44
1.7 DIMM	45
1.7.1 サポートする最大 DIMM 容量	45
1.7.2 メモリクロック	46
1.7.3 メモリ RAS 機能	47
1.7.4 DIMM の増設順序	47
1.7.5 取り付け	49
1.7.6 メモリ機能の利用	49
1.8 RAID コントローラ用フラッシュバックアップユニット	57
1.8.1 取り扱い上の注意	57
1.8.2 NE3303-181 フラッシュバックアップユニットの取り付け	57
1.9 LOM カード	57
1.9.1 取り付け	57
1.10 増設・冗長ファン	58
1.10.1 取り付け	58
1.11 バックアップ装置	59
1.11.1 取り付け	59
1.12 PCI ボード	59
1.12.1 注意事項	59
1.12.2 サポートしているボードと搭載可能スロット	60
1.12.3 取り付け	62
1.12.4 RAID コントローラーの取り付け手順	62
1.13 2.5型 HDD ケージ	63
1.13.1 取り付け	63
1.14 光ディスクドライブ	63
1.14.1 取り付け	63
1.15 内蔵ハードディスクドライブによる RAID システム	64
1.15.1 RAID システム構築時の注意事項	64
1.16 ハードディスクドライブ	66
1.16.1 取り付け	66
1.16.2 取り外し	68
1.16.3 RAID システムでのハードディスクドライブの交換について(オートリビルド)	68
1.17 電源ユニット	69
1.17.1 コールドリダンダント機能	69
1.17.2 取り付け	69
1.18 フロントベゼルの取り付け	70
2. 設置と接続	71
2.1 設 置	71
2.1.1 ラックの設置	71
2.1.2 ラックへの取り付け/ラックからの取り外し	73
2.2 接 続	79
2.2.1 無停電電源装置(UPS)への接続について	81
3章 セットアップ	82
1. 電源の ON	83
1.1 POST のチェック	84
1.1.1 POST の流れ	84
1.1.2 POST のエラーメッセージ	85

2. システム BIOS のセットアップ(SETUP の説明)	86
2.1 概 要	86
2.2 起 動	86
2.3 キー操作と画面の説明	87
2.4 設定が必要なケース	89
3. EXPRESSSCOPE エンジン 3	91
3.1 概 要	91
3.2 EXPRESSSCOPE エンジン 3 のネットワーク設定	91
4. EXPRESSBUILDER	93
4.1 EXPRESSBUILDER が提供する機能	93
4.2 EXPRESSBUILDER の起動	93
5. ソフトウェアのインストール	94
6. 電源の OFF	95
4章 付 錄	96
1. 仕 様	97
2. 割り込みライン	101
3. 用語集	102
4. 改版履歴	104

本書で使う表記

本文中の記号

本書では安全にかかわる注意記号のほかに3種類の記号を使用しています。これらの記号は、次のような意味があります。

	ハードウェアの取り扱い、ソフトウェアの操作などにおいて、守らなければならないことについて示しています。記載の手順に従わないときは、ハードウェアの故障、データの損失など、 重大な不具合が起きるおそれがあります。
	ハードウェアの取り扱い、ソフトウェアの操作などにおいて、確認しておかなければならないことについて示しています。
	知っておくと役に立つ情報、便利なことについて示しています。

「光ディスクドライブ」の表記

本機は、購入時のオーダーによって以下のいずれかのドライブを装備できます。本書では、これらのドライブを「光ディスクドライブ」と記載しています。

- DVD-ROM ドライブ

「ハードディスクドライブ」の表記

本書で記載のハードディスクドライブとは、特に記載のない限り以下の両方を意味します。

- ハードディスクドライブ(HDD)
- ソリッドステートドライブ(SSD)

「リムーバブルメディア」の表記

本書で記載のリムーバブルメディアとは、特に記載のない限り以下の両方を意味します。

- USB メモリ
- Flash FDD

オペレーティングシステムの表記(Linux)

本書では、Linux オペレーティングシステムを次のように表記します。

本機でサポートしているLinux OSの詳細は、別途購入の「Enterprise Linux with Dependable Support」製品に含まれている「インストレーションガイド」を参照してください。

本書の表記

Red Hat Enterprise Linux

「POST」の表記

本書で記載の POST とは以下を意味します。

- Power On Self-Test

「BMC」の表記

本書で記載の BMC とは以下を意味します。

- Baseboard Management Controller

商 標

EXPRESSBUILDERとESMPRO、EXPRESSSCOPE、ExpressUpdateは日本電気株式会社の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Server、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、Pentium、Xeonは米国Intel Corporationの登録商標です。ATIは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Adaptecとそのロゴ、SCSISelectは米国Adaptec, Inc.の登録商標または商標です。Avago、LSIおよびLSIロゴ・デザインはAvago Technologies(アバゴ・テクノロジー社)の商標または登録商標です。Adobe、Adobeロゴ、Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。DLTとDLTtapeは米国Quantum Corporationの商標です。PCI EXPRESSはPeripheral Component Interconnect Special Interest Groupの商標です。Linux[®]は、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。Red Hat[®]、Red Hat Enterprise Linuxは、米国Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

ライセンス通知

本製品の一部（システムBIOS）には下記ライセンスのオープンソースソフトウェアが含まれています。

- EDK from TIANOCORE.ORG
- UEFI Network Stack 2
- Crypto package using WPA Supplicant

本製品の一部（オンラインツール）には下記ライセンスのオープンソースソフトウェアが含まれています。

- EDK from TIANOCORE.ORG

ライセンス文

EDK FROM TIANOCORE.ORG

BSD License from Intel

Copyright (c) 2012, Intel Corporation

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2004 - 2007, Intel Corporation

All rights reserved. This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at <http://opensource.org/licenses/bsd-license.php>

THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

UEFI NETWORK STACK 2

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

CRYPTO PACKAGE USING WPA SUPPLICANT

WPA Supplicant

Copyright (c) 2003-2012, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.

This program is licensed under the BSD license (the one with advertisement clause removed).
If you are submitting changes to the project, please see CONTRIBUTIONS file for more instructions.

License

This software may be distributed, used, and modified under the terms of
BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

本書についての注意、補足

1. 本書の一部または全部を無断転載することを禁じます。
2. 本書に関しては将来予告なしに変更することがあります。
3. 弊社の許可なく複製、改変することを禁じます。
4. 本書について誤記、記載漏れなどお気づきの点があった場合、弊社担当営業までご連絡ください。
5. 運用した結果の影響については、4 項に関わらず弊社は一切責任を負いません。
6. 本書の説明で用いられているサンプル値は、すべて架空のものです。

この説明書は、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いてください。

最新版

本書は作成日時点の情報をもとに作られており、画面イメージ、メッセージ、または手順などが実際のものと異なるときがあります。 変更されているときは適宜読み替えてください。

また、ユーザーズガイドをはじめとするドキュメントは、次の Web サイトから最新版をダウンロードすることができます。

<http://www.nec.co.jp/>

安全にかかわる表示について

本製品を安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してください。

ユーザーズガイドは、本機のどこが危険でどのような危険に遭うおそれがあるか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明しています。また、本機で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています(印刷されている場合もあります)。

ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義しています。



人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。

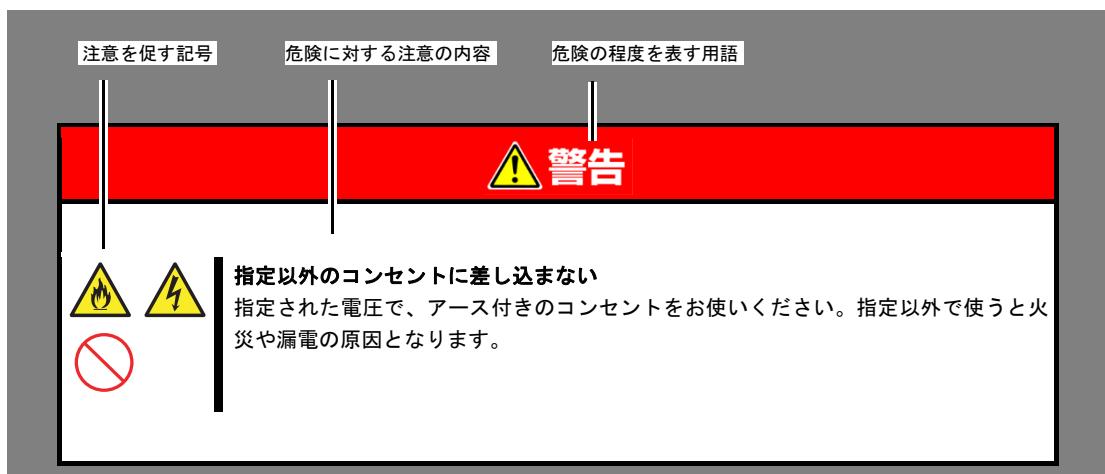


火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示します。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義しています。

	注意の喚起	この記号は危険が発生するおそれがあることを表します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。	(例)
	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。	(例)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例)

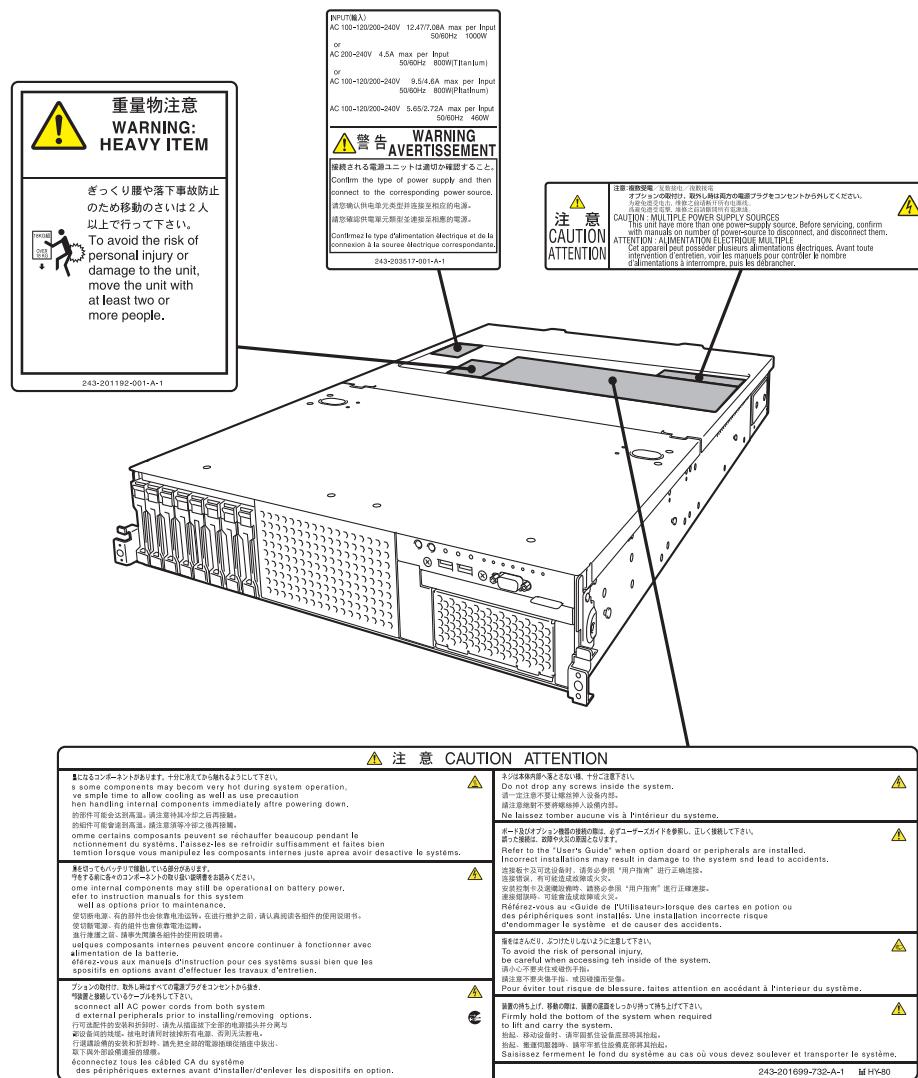
(ユーザーズガイドでの表示例)



安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、本機に添付されている「安全にご利用いただくために」をよく読んでください。本製品のドキュメント内の記号については、「安全にご利用いただくために」の「安全にかかる表示について」を参照してください。

危険性のある部品やその周辺には警告ラベルがあります(印刷またはシールが貼られています)。ラベルをはがしたり、塗りつぶしたり、汚したりしないでください。このラベルがないときは弊社担当営業まで連絡してください。



取り扱い上のご注意(正しくお使いいただくために)

本製品を正しく動作させるため、次の注意事項を守ってください。これらの注意を無視した取り扱いをすると誤動作や故障の原因になります。

- 電波による影響を避けるため、本機の近くでは携帯電話やPHSの電源をOFFにしてください。
- 「2章(2. 設置と接続)」を参照し、適切な場所へ本機を設置してください。
- プラグアンドプレイに対応していない周辺機器のケーブル接続/取り外しは、本機の電源がOFFになっていることを確認し、電源コードをコンセントから外した後に行ってください。
- 電源を入れるときは、100Vまたは200Vのコンセントへ添付の電源コードを接続してください。
- 電源OFFやDISK/光ディスクを取り出す場合は、DISK/光ディスクアクセスランプが消灯していることを確認してください。
- 電源コードをコンセントから抜いた後、再び接続するときは30秒以上経過してから接続してください。
- 無停電電源装置(UPS)に接続している場合は、30秒以上経過してからONになるようにスケジュールを設定してください。
- 本機の電源コードをコンセントに接続した後は、STATUSランプ2(アンバー点灯)が消灯するまでは電源をONしないでください。
- 本機の電源をOFFした後、再びONするときは30秒以上経過してからONしてください。
- 本機を移動させるときは、電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 定期的に清掃してください(清掃は「メンテナンスガイド」の「1章(2. 日常の保守)」で説明しています)。
- 落雷などが原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策としてUPSなどを使うことをお勧めします。
- CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクは、本機の光ディスクドライブによる再生は保証できません。
- 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。
 - 輸送後
 - 長期に保管した後
 - 動作を保証する環境(温度:10~40°C・湿度:20%~80%)から外れた状態で休止状態にした後
- システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高精度な時刻を要求するシステムの場合は、タイムサーバ(NTPサーバ)などを利用することをお勧めします。
- 長期に保管する場合は、保管環境条件(温度:-10°C~55°C、湿度:20%~80%、ただし、結露しないこと)を守って保管してください。
- 電源ON後、POST終了までは、電源OFF、リセット、または電源コードを抜かないでください。
- 本機、内蔵型のオプション機器、バックアップ装置にセットするメディア(テープカートリッジ)などは、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤動作や故障の原因になります。保管した大切なデータや資産を守るためにも、使用環境に十分になじませてからお使いください。

参考:冬季(室温と10度以上の気温差)の結露防止に有効な時間

ディスク装置:約2~3時間 メディア:約1日

- オプションは弊社の純正品をお使いになることをお勧めします。取り付けや接続ができても、弊社が動作を確認していない機器については、正常に動作しないばかりか、本機が故障することがあります。これらの製品が原因となって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。



保守サービスについて

本製品は、専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断・保守サービスを用意しています。よい状態で使い続けるためにも、保守サービス会社と定期保守サービスを契約することをお勧めします。

取り扱い上のご注意(静電気対策について)

本機内部の部品は、静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け、取外しの際には、静電気による製品の故障を防止するために以下の注意事項を守ってください。

● 静電気対策用リストストラップや静電気防止手袋などの着用

リストストラップを手首に巻き付け、アース線を接地してから作業してください。リストストラップがないときは、部品を触る前に接地された筐体の塗装されていない金属表面に触れて身体に蓄積された静電気を放電してください。また、作業中も定期的に金属表面に触れて静電気を放電するようにしてください。

● 作業場所の確認

- 静電気防止処理が施された床、またはコンクリートの上で作業してください。
- カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業するときは、静電気防止処理をした上で作業してください。

● 作業台の使用

静電気防止マットの上に本機を置き、その上で作業してください。

● 着衣

- ウールや化学繊維で出来た服を身につけて作業しないでください。
- 静電気防止靴を履いて作業してください。
- 取り付け前に貴金属(指輪や腕輪、時計など)を外してください。

● 部品の取り扱い

- 部品は、本機に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。
- 各部品の縁の部分を持ち、端子や実装部品に触れないでください。
- 部品を保管、運搬するときは、静電気防止用の袋などに入れてください。

● ケーブルの取り扱い

LAN ケーブル等も床面との摩擦によって静電気が帯電することがあります。帯電した状態で接続すると機器を破壊することがあります。接続する前に、除電キット等を使用して除電することを推奨します。

下記の静電気除電キットについては、保守サービス会社にご相談ください。

品名：LAN ケーブル除電治具
型名：SG001(東京下田工業(株)製)

● オプションの取り付け/取外しについて

- 危険および故障を防止するため、作業時は、本機の電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ホットスワップ(活線挿抜)対象製品の取り付け、取外しは、電源スイッチを OFF にする必要はありません。
- オプション製品の取り付け、取り外しは、静電気による製品の故障を防止するため、静電気対策用リストストラップなどの装着により静電気を除去してください。また、リストストラップを使用する場合は、接地されたアース線を接続して使用してください。

健康を損なわないためのアドバイス

コンピューター機器を長時間連続して使用すると、身体の各部に異常が起こることがあります。コンピューターを使用するときは、主に次の点に注意して身体に負担がかからないよう心掛けましょう。

よい作業姿勢で

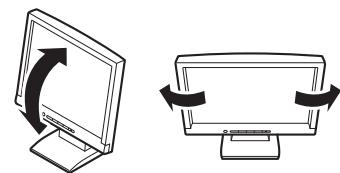
コンピューターを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして椅子にすわり、キーボードを両手と床がほぼ平行になるような高さに置き、視線が目の高さよりもやや下向きに画面に注がれているという姿勢です。『よい作業姿勢』とはこの基本的な姿勢をとったとき、身体のどの部分にも余分な力が入っていない、つまり緊張している筋肉がもっとも少ない姿勢のことです。

『悪い作業姿勢』、たとえば背中を丸めたかっこうやディスプレイ装置の画面に顔を近づけたままの状態で作業を行うと、疲労の原因や視力低下の原因となることがあります。



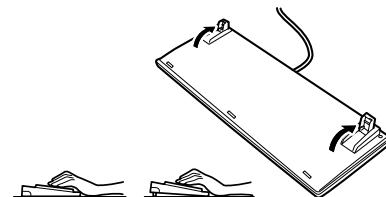
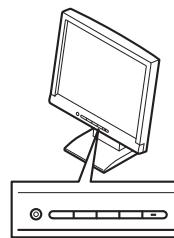
ディスプレイの角度を調節する

ディスプレイの多くは上下、左右の角度調節ができるようになっています。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見やすくしたりするためにディスプレイの角度を調節することは、たいへん重要です。角度調節をせずに見づらい角度のまま作業を行うと『よい作業姿勢』を保てなくなりすぐに疲労してしまいます。ご使用の前にディスプレイを見やすいよう角度を調整してください。



画面の明るさ・コントラストを調節する

ディスプレイは明るさ(ブライトネス)・コントラストを調節できる機能を持っています。年齢や個人差、まわりの明るさなどによって、画面の最適なブライトネス・コントラストは異なりますので、状況に応じて画面を見やすいように調節してください。画面が明るすぎたり、暗すぎたりすると目に悪影響をもたらします。



キーボードの角度を調節する

オプションのキーボードには、角度を変えることができるよう設計されているものもあります。入力しやすいようにキーボードの角度を変えることは、肩や腕、指への負担を軽減するのにたいへん有効です。

機器の清掃をする

機器をきれいに保つことは、美観の面からだけでなく、機能や安全上の観点からも大切です。特にディスプレイの画面は、ほこりなどで汚れると、表示内容が見にくくなりますので定期的に清掃する必要があります。

疲れたら休む

疲れを感じたら手を休め、軽い体操をするなど、気分転換をはかることをお勧めします。



NEC NX7700x シリーズ NX7700x/A3010E-2

1

概要

本製品を導入する際に知っておいていただきたいことについて説明します。

1. はじめに

2. 付属品の確認

本製品の付属品について説明しています。

3. 特長

本製品の特長とシステム管理について説明しています。

4. 各部の名称と機能

各部の名称と機能についてパーツ単位で説明しています。

I. はじめに

このたびは、NEC の NX7700x シリーズ製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本機は、最新のマイクロプロセッサー「インテル® Xeon® プロセッサー」を搭載した高性能サーバーです。

弊社の最新テクノロジーとアーキテクチャーにより、従来のサーバーでは実現できなかったハイパワー、ハイスピードを実現します。

「高信頼性」はもちろんのこと、「拡張性」を考慮して設計され、ネットワークサーバーとして幅広くご利用いただけることでしょう。

本機の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、製品の取り扱いを十分にご理解ください。

2. 付属品の確認

梱包箱の中にはさまざまな付属品が入っています。これらの付属品は、セットアップ、保守などにおいて必要となりますので大切に保管してください。

- フロントベゼル
- ベゼルロックキー(フロントベゼルに貼り付けられています)
- スライドレール
- EXPRESSBUILDER ¹
- 「安全にご利用いただくために」
- 保証書(梱包箱に貼り付けられています)
- スタートアップガイド
- SAS/SATA ケーブル(RAID コントローラー未実装時に添付されます)
- 内蔵バックアップデバイス用固定ネジ(x6)
- リモートマネジメント拡張ライセンス

¹ ドキュメントは、「EXPRESSBUILDER」内に格納されています。参照するには、Adobe Reader が必要となりますので、あらかじめご使用の PC へインストールしておいてください。

すべてが揃っていることを確認し、それぞれ点検してください。万一足りないものや損傷しているものがあるときは、弊社担当営業まで連絡してください。



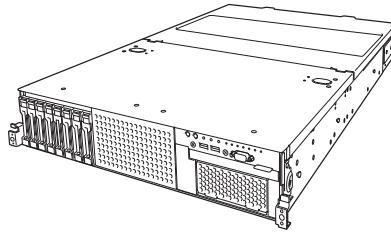
本機には、製品の製造番号などが記載された銘板や、保守ラベルが貼ってあります。銘板に記載の製造番号と保証書の番号が一致しているか確認してください。これらが一致していないと、保証期間内に故障したときでも保証を受けられないことがあります。万一違うときは、弊社担当営業まで連絡してください。



セットモデルや BTO(工場組込み出荷)製品などは「組込製品・添付品リスト」も併せて確認してください。

3. 特長

本製品の特長は次のとおりです。



高性能

- ・インテル Xeon プロセッサー搭載
 - NE3300-201Y : インテル Xeon プロセッサー E5-2609 v3 (1.90GHz 6Core)
 - NE3300-202Y : インテル Xeon プロセッサー E5-2623 v3 (3GHz 4Core)
 - NE3300-203Y : インテル Xeon プロセッサー E5-2637 v3 (3.50GHz 4Core)
 - NE3300-204Y : インテル Xeon プロセッサー E5-2640 v3 (2.60GHz 8Core)
 - NE3300-205Y : インテル Xeon プロセッサー E5-2643 v3 (3.40GHz 6Core)
 - NE3300-206Y : インテル Xeon プロセッサー E5-2660 v3 (2.60GHz 10Core)
 - NE3300-207Y : インテル Xeon プロセッサー E5-2667 v3 (3.20GHz 8Core)
 - NE3300-208Y : インテル Xeon プロセッサー E5-2690 v3 (2.60GHz 12Core)
 - NE3300-209Y : インテル Xeon プロセッサー E5-2697 v3 (2.60GHz 14Core)
 - NE3300-210Y : インテル Xeon プロセッサー E5-2699 v3 (2.30GHz 18Core)
- ・インテル ターボ・ブースト・テクノロジー機能 *1
- ・インテル ハイパースレッディング・テクノロジー機能 *1
- ・高速メモリアクセス(DDR4 1600 / 1866 / 2133 対応) *2
- ・高速ディスクアクセス(SAS 12Gb/s 対応)
- ・高速 10GBASE-SFP+/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T インターフェース
(10Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps 対応)を選択して搭載可能

高信頼性

- ・プロセッサースロットリング機能
- ・メモリ監視機能(エラー訂正/エラー検出)
- ・メモリ縮退機能(障害を起こしたデバイスの論理的な切り離し)
- ・メモリ x4 SDDC 対応(一部メモリで利用できます)
- ・メモリミラーリング機能/メモリロックステップ機能(x8 SDDC)/メモリスペアリング機能
- ・メモリスロットリング機能
- ・バスパリティエラー検出
- ・温度検知
- ・異常検知
- ・内部ファン回転監視機能
- ・内部電圧監視機能
- ・電源ユニットの冗長機能(ホットスワップ対応)
- ・RAID システム(ディスクアレイ)(オプションカードが必要)
- ・オートリビルド機能(ホットスワップ対応)

- ・ BIOS パスワード機能
- ・ フロントベゼルによるロック
- ・ 冗長ファン機能
- ・ ファン(ホットスワップ対応)
- ・ HDD(ホットスワップ対応)

管理機能

- ・ サーバー管理ソフトウェア(ESMPRO プロダクト)
- ・ システム BIOS、ファームウェア管理機能(ExpressUpdate 機能)
- ・ 遠隔監視機能(EXPRESSSCOPE エンジン 3)
- ・ RAID システム管理ユーティリティー(Universal RAID Utility)
- ・ ハードディスクドライブ監視
- ・ 電源監視機能

省電力・静音性

- ・ 環境、負荷、構成に応じた最適な電源ユニットの選択。
- ・ 電力監視機能
- ・ 電力制御機能
- ・ 80 PLUS® Platinum/ Titanium 取得の高効率電源ユニット *5
- ・ 環境/負荷/構成に応じたきめ細やかな FAN 制御
- ・ 静音設計
- ・ Enhanced Intel SpeedStep® Technology に対応
- ・ コールドリダンダント機能

拡張性

- ・ 豊富なオプションスロット
- PCI Express 3.0 (x8 レーン) : 3 スロット(フルハイト)
- PCI Express 3.0 (x8 レーン) : 3 スロット(ロープロファイル)
- PCI Express 3.0 (x8 レーン) : 1 スロット(RAID コントローラー専用スロット)
- PCI Express 3.0 (x8 レーン) : 1 スロット(LOM カード専用スロット)
- ・ 最大 768GB の大容量メモリ*3
- ・ 最大 2 マルチプロセッサーまでアップグレード可能
- ・ 拡張ベイ(ハードディスクドライブ用) : 16 スロット*4
- ・ 光ディスクドライブベイを標準装備
- ・ バックアップ装置用の拡張ベイを標準装備
- ・ USB3.0 対応(前面 : 2 ポート、背面 : 2 ポート、内部 : 1 ポート)
- ・ USB2.0 対応(背面 2 ポート、内部 : 1 ポート)
- ・ マネージメント専用 LAN を 1 ポート装備
- ・ オプションの専用 LOM カードにて LAN2-4 ポートを選択して搭載可能

すぐに使える

- ・ハードディスクドライブ、増設用電源ユニット、冗長ファンはケーブルを必要としないワンタッチ取り付け
(ホットスワップ対応)
- ・ワンタッチで取り付け可能なスライド式レール

豊富な機能搭載

- ・冗長電源対応(オプション増設時に有効)
- ・El Torito Bootable CD-ROM(no emulation mode)フォーマットをサポート
- ・ソフトウェア Power Off
- ・リモートパワーオン機能
- ・AC リンク機能
- ・コンソールレス機能
- ・POWER スイッチマスク
- ・フロントにディスプレイコネクタを装備
- ・IPMI v2.0 に準拠したベースボードマネージメントコントローラー(BMC)を搭載

自己診断機能

- ・Power On Self-Test(POST)
- ・システム診断(T&D)ユーティリティー

便利なセットアップユーティリティー

- ・EXPRESSBUILDER(セットアップユーティリティー)
- ・BIOS セットアップユーティリティー(SETUP)

保守機能

- ・オフラインツール
- ・DUMP スイッチによるメモリダンプ機能
- ・EXPRESSSCOPE プロファイルキーによる BIOS/BMC 設定情報のバックアップリストア機能

*1：インテル Xeon プロセッサーE5-2609 v3 搭載モデルは未サポート。

*2：搭載するプロセッサー やメモリの種類、搭載枚数により動作する周波数が変動します。

*3：2CPU 構成時。1CPU 構成時は、最大 384GB。

*4：NE3354-H201 2.5 型 HDD ケージ搭載時。標準構成では 8 スロット。

*5：NE3281-118 電源ユニット搭載時。NE3381-121/122/123 電源ユニットは 80 PLUS Platinum 取得。

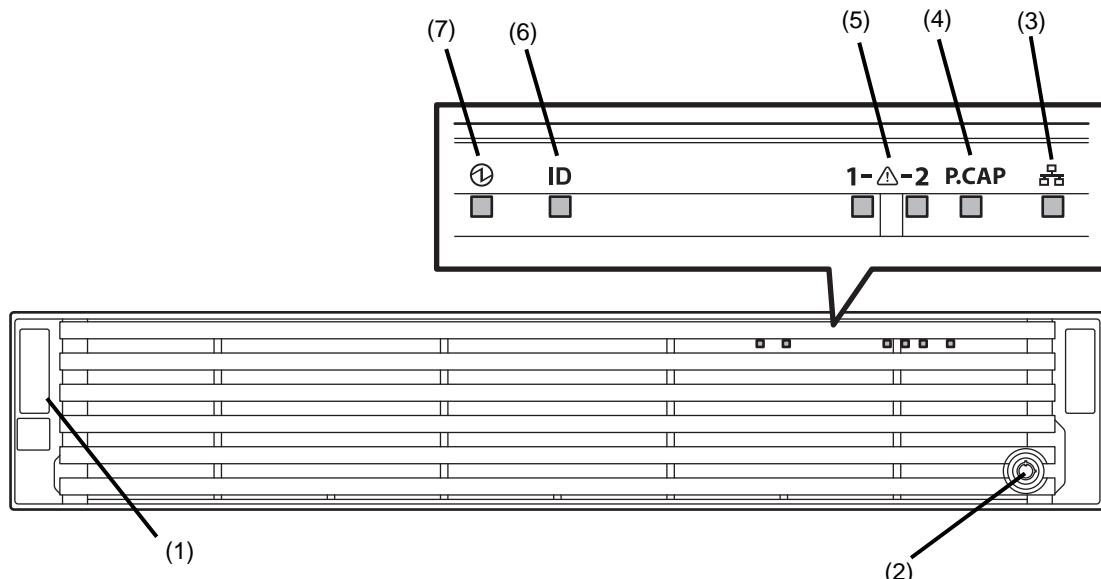
3.1 ファームウェアおよびソフトウェアのバージョン管理

ESMPRO/ServerManager、ExpressUpdate Agent、EXPRESSSCOPE エンジン 3 を使うことにより、本機のファームウェアやソフトウェアなどをバージョン管理し、更新パッケージを適用して更新することができます。ESMPRO/ServerManager から更新パッケージの適用を指示するだけで、複数のモジュールに対し、システムを停止せずに自動で更新します。

4. 各部の名称と機能

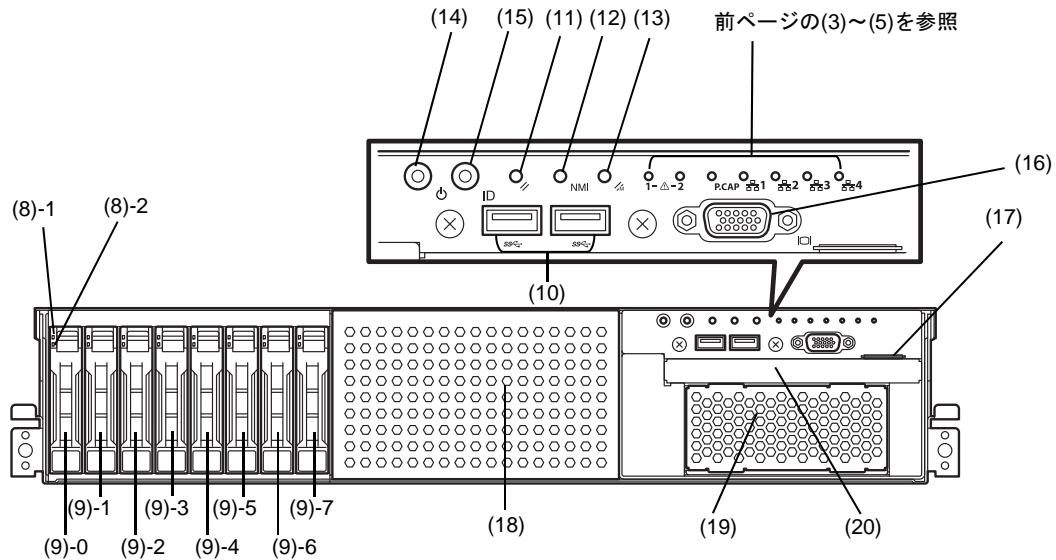
各部の名称について説明します。

4.1 前面



- | | |
|--|--|
| (1) フロントベゼル
前面を保護するカバー。添付のベゼルロックキーでロックすることができる。 | (5) STATUSランプ 1, 2
本機の状態を表す。
(→32ページ) |
| (2) キースロット
フロントベゼルをロックする鍵の鍵穴。 | (6) UID(ユニットID)ランプ
ユニットIDランプのON/OFF状態を表す。
(→33ページ) |
| (3) LINK/ACTランプ
ネットワーク接続の状態を表す。
(→33ページ)
括弧数字の後の数字は「1」がLAN1コネクタ、「2」がLAN2コネクタ、「3」がLAN3コネクタ、「4」がLAN4コネクタを表す。
LAN3、LAN4はオプションのLOMカードNE3304-154/156搭載時に点灯する。 | (7) POWERランプ
本機の電源状態を表す。
(→31ページ) |
| (4) Power Cappingランプ
本機のECO状態を表す。
(→34ページ) | |

4.2 前面(フロントベゼルを取り外した状態)



(8) DISKランプ

-1 DISKランプ1 (緑色)
-2 DISKランプ2 (アンバー色)
各ハードディスクドライブにあるランプ。
ハードディスクドライブの状態を表す。
(→34ページ)

(9) 2.5型ドライブベイ

ハードディスクドライブを搭載するベイ。
末尾の数字はスロット番号を表す。
標準では、すべての空きスロットにダミートレーが搭載されている。

(10) USBコネクタ(フロント)

USBインターフェースに対応している機器と接続する。

(11) RESETスイッチ

本機をリセットするスイッチ。

(12) DUMP(NMI)スイッチ

押すとメモリダンプを実行する。

(13) BMC RESETスイッチ

本機のBMCをリセットするスイッチ。
EXPRESSSCOPEエンジン3(BMC)に問題が発生している場合にのみ使用する。
使用する場合は、スイッチを5秒間押し続ける。

(14) POWERスイッチ/ランプ

電源をON/OFFするスイッチ。一度押すとPOWERランプが点灯し、ONの状態になる。
もう一度押すと電源をOFFにする。
4秒以上押し続けると強制的に電源をOFFにする。(→31ページ)

(15) UID(ユニットID)スイッチ/ランプ

ユニットIDランプをON/OFFするスイッチ。
一度押すとUIDランプが点灯し、ONの状態になる。もう一度押すとOFFにする。
ソフトウェアからのコマンドによりUIDランプが点灯または点滅する。
(→33ページ)

(16) ディスプレイコネクタ *1

ディスプレイと接続する。
背面のディスプレイコネクタとは同時に使いえない。

(17) スライドタグ

型番、製造番号を記載したラベルが貼り付けられている。

(18) 2.5型増設HDDケージベイ

NE3354-H201 2.5型HDDケージを取り付けるベイ。

(19) 拡張ベイ(バックアップ装置用)

オプションのRDXドライブを取り付けるベイ。

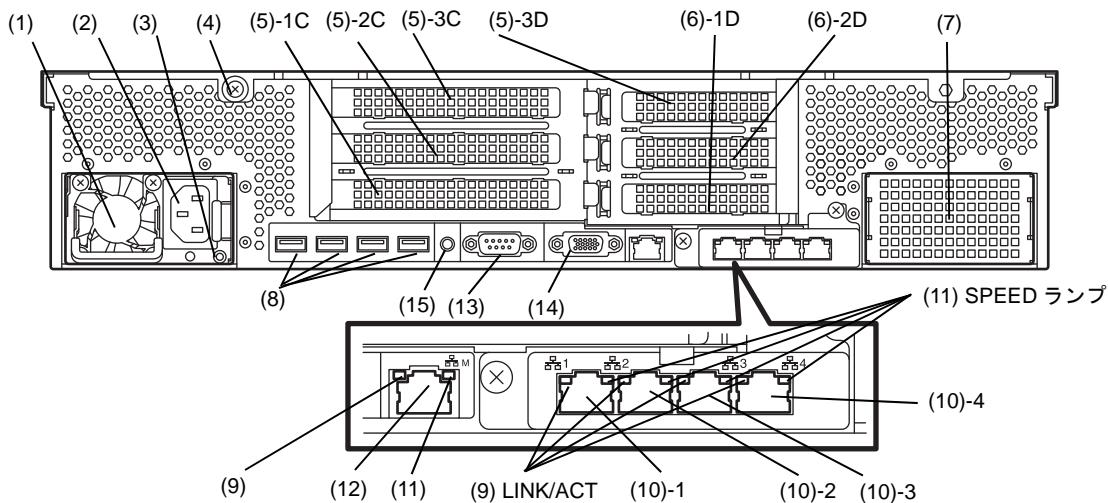
(20) 光ディスクドライブベイ

光ディスクドライブを取り付けるベイ。
購入時のオーダーによって、以下いずれかのオプションドライブが搭載される。
- DVD-ROMドライブ

*1: ディスプレイケーブルのコネクタによっては光ディスクドライブのトレーが開かないことがあります。

その場合、ディスプレイケーブルを取り外してからトレーを開閉してください。

4.3 背面

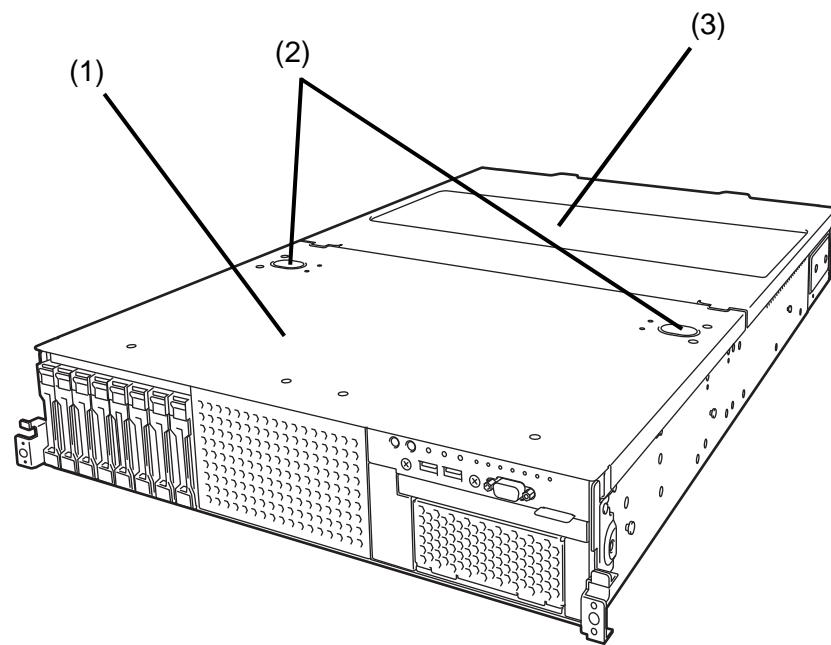


- (1) **電源ユニット(パワーサプライスロット1)**
本機にDC電源を供給する。
- (2) **ACインレット**
電源コードを接続するソケット。
- (3) **AC POWERランプ**
電源の状態を示すランプ。(→36ページ)
- (4) **カバー固定ネジ**
トップカバーを固定するネジ。
- (5) **フルハイトPCIボード増設用スロット**
フルハイトのPCIボードを取り付けるスロット。括弧数字の後ろの数字はPCIスロット番号を示す。
- (6) **ロープロファイルPCIボード増設用スロット**
ロープロファイルのPCIボードを取り付けるスロット。括弧数字の後ろの数字はPCIスロット番号を示す。
- (7) **ブランクカバー(電源ユニット2用)**
2台目の電源ユニットを搭載するベイをふさぐカバー。
- (8) **USBコネクタ**
USBインターフェースに対応している機器と接続する。
- (9) **LINK/ACTランプ *1**
LANのアクセス状態を示すランプ。(→33ページ)
- (10) **LANコネクタ *1**
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応のコネクタ。括弧数字の後の数字は「1」がLAN1コネクタで「2」がLAN2コネクタを示す。
ROM Utilityの設定でShared BMC LAN機能をEnableにすると、LAN1コネクタをマネージメント専用LANとして共用することが可能。ただし、両方のデータを送受信する可能性があるため、性能およびセキュリティーの面で非推奨。
- (11) **SPEEDランプ *1**
LANの転送速度を示すランプ。(→35ページ)
- (12) **マネージメント専用LANコネクタ**
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応のコネクタ。
通常のLANとしては使用不可。
EXPRESSSCOPEエンジン3との接続のみに使用する。
- (13) **シリアルポート(COM)A**
シリアルインターフェースを持つ装置と接続する。専用回線に直接接続することは不可。
- (14) **ディスプレイコネクタ**
ディスプレイと接続する。
前面のディスプレイコネクタとは同時に使いえない。
- (15) **UID(ユニットID)スイッチ/ランプ**
ユニットIDランプをON/OFFするスイッチ。
一度押すとUIDランプが点灯し、ONの状態になる。もう一度押すとOFFにする。
ソフトウェアからのコマンドによりUIDランプが点灯または点滅する。(→33ページ)

*1 : LOM カードはオプションです。

イラストはNE3304-154実装状態を示す。

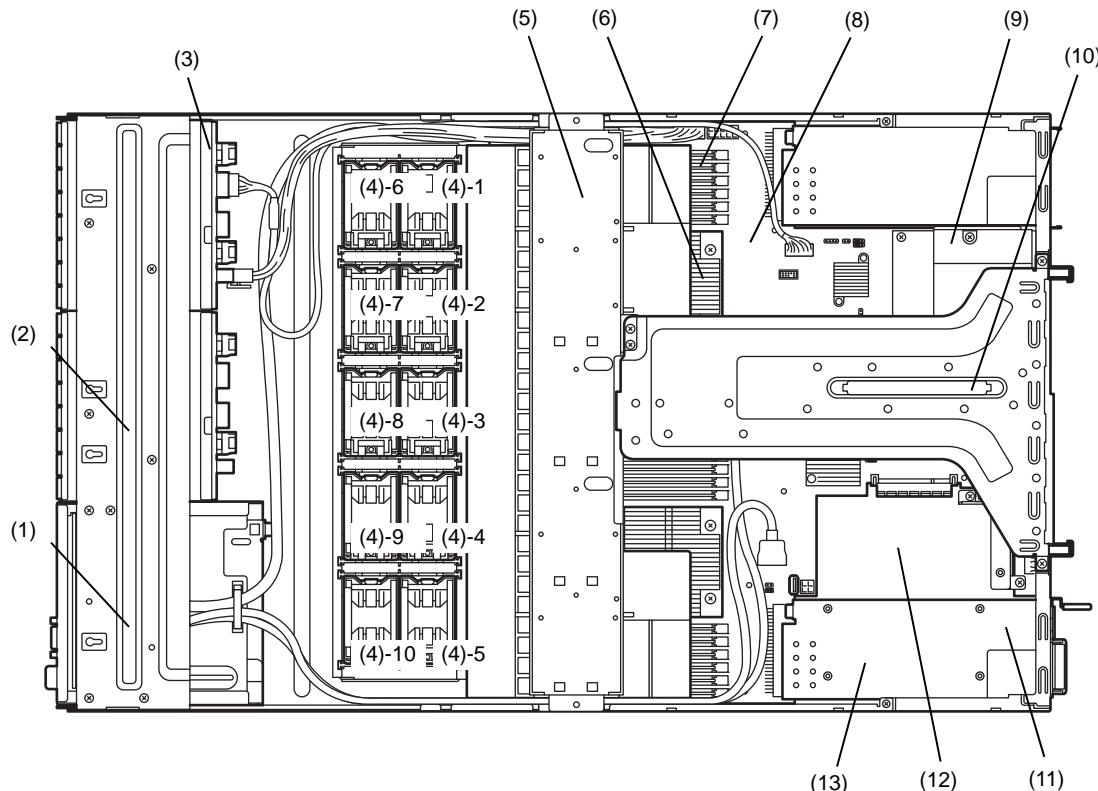
4.4 外観



- (1) トップカバー(フロント)
- (2) リリースボタン
- (3) トップカバー(リア)

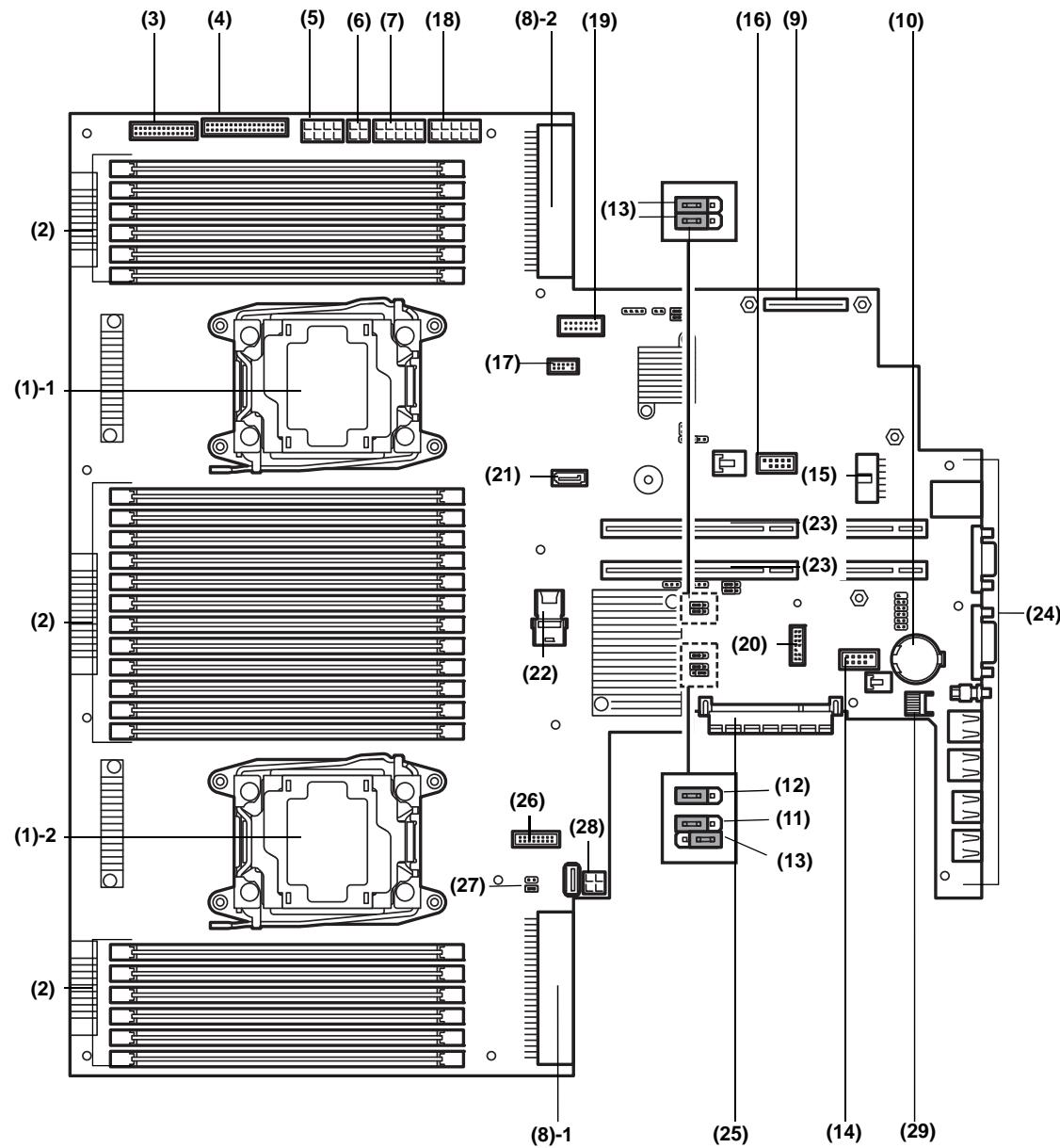
4.5 内部

図は、ダクトを省略しています。



- (1) フロントパネルボード(保護カバーの下に取り付けられている)
- (2) 保護カバー
- (3) バックプレーン
- (4) 冷却ファン
- 1 FAN1R
 - 2 FAN2R
 - 3 FAN3R
 - 4 FAN4R
 - 5 FAN5R(オプション)
 - 6 FAN1F(オプション)
 - 7 FAN2F(オプション)
 - 8 FAN3F(オプション)
 - 9 FAN4F(オプション)
 - 10 FAN5F(オプション)
- FAN1R～4Rは標準搭載。FAN5Rは2CPU構成時に搭載。FAN1F～5F*は冗長ファンオプション手配時に搭載。
- * 1CPU構成時はFAN1F～4F
2CPU構成時はFAN1F～5F
- (5) サポートバー(バッテリーユニット等を搭載可能)
- (6) プロセッサー(CPU、ヒートシンクの下に取り付けられている)
- (7) DIMM(オプション)
- (8) マザーボード
- (9) LOMカード専用スロット
PCIスロット番号は「1B」。
- (10) ライザーカード
- (11) 電源ユニット
- (12) RAIDコントローラー専用スロット
PCIスロット番号は「1A」。
- (13) 拡張ベイ

4.6 マザーボード



- | | |
|-----------------------|---|
| (1) プロセッサー(CPU)ソケット | (17) SPIメザニンカード用コネクタ |
| -1 プロセッサー#1(CPU#1) | EXPRESSSCOPE プロファイルキー(SPIメモリ)が実装済み。BIOS, BMCの設定情報が格納されており、MB交換時に移設することで設定を引き継ぐ。 |
| -2 プロセッサー#2(CPU#2) | |
| (2) DIMMソケット | (18) オプションHDDケージ用電源コネクタ |
| (3) フロントパネル用コネクタ | (19) フロントディスプレイ用コネクタ |
| (4) ファンボード用コネクタ | (20) TPMキット用コネクタ |
| (5) ファン用電源コネクタ | (21) SATA光ディスクドライブ用コネクタ |
| (6) SATA光ディスク用電源コネクタ | (22) SATAコネクタ |
| (7) HDDケージ用電源コネクタ | (23) PCIライザーカード用コネクタ |
| (8) 電源コネクタ | 搭載可能なボードの仕様については、本書の「2章(1.12 PCIボード)」を参照。 |
| -1 標準電源コネクタ(POW#1) | (24) 外部接続コネクタ
(→27ページ) |
| -2 冗長電源コネクタ(POW#2) | (25) RAIDコントローラ用コネクタ |
| (9) LOMカード用コネクタ | (26) USBコネクタ(フロント) |
| (10) リチウム電池 | (27) USBバックアップ装置用コネクタ |
| (11) CMOSクリアジャンパー | (28) エキスパンダーボード用電源コネクタ |
| (12) パスワードクリアジャンパー | |
| (13) 未使用ジャンパー | |
| (14) USBメモリモジュール用コネクタ | |
| (15) HDD BP用コネクタ | |
| (16) オプションCOM用コネクタ | |

4.7 ランプ表示

4.7.1 POWER ランプ (ledon)

本機の電源 ON/OFF の状態を示しています。

POWERランプの状態	意味
緑色に点灯	正常に動作しています。
消灯	本機の電源がOFFの状態です。 本機が停止しています。

4.7.2 STATUS ランプ (▲)

ハードウェアが正常に動作していると、STATUS ランプ 1 は緑色点灯、STATUS ランプ 2 は消灯します。STATUS ランプ 1 が消灯しているときや、STATUS ランプ 2 がアンバー色に点灯または点滅しているときは、ハードウェアになんらかの異常が起きたことを示します。



ESMPRO からエラーログを参照することで故障の原因を確認できます。

STATUSランプ1, 2の状態		意味	対処方法
STATUSランプ1	STATUSランプ2		
緑色に点灯	消灯	正常に動作しています。	—
緑色に点灯	アンバー色に点灯	BMCの初期化中です。	初期化完了(消灯)するまでお待ちください。
緑色に点滅	消灯	メモリが縮退した状態で動作しています。 メモリ修復可能エラーが多発しています。 CPUエラーを検出した状態で動作しています。 冗長電源構成で片側の電源に電力供給されていない状態です。	BIOSセットアップユーティリティー(SETUP)を使って縮退しているデバイスを確認後、早急に交換することをお勧めします。
消灯	消灯	電源がOFFになっています。	電源をONにしてください。
		POST中です。	POST完了後、しばらくすると緑色に点灯します。
		ウォッチドッグタイマーのタイムアウトがきました。	いったん電源をOFFにして、電源をONにし直してください。POSTで何らかのエラーメッセージが表示されたときは、メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。
		メモリダンプリクエスト中です。 (DUMPスイッチを押したときなど) ※ソフトウェア要因のダンプ中は緑点灯のままです。	ダンプが終わるまでお待ちください。
消灯	アンバー色に点灯	温度異常を検出しました。	内部のファンにホコリやチリが付着していないかどうか確認してください。また、ファンユニットが確実に接続されていることを確認してください。 それでも表示が変わらないときは、保守サービス会社に連絡してください。
		CPUでエラーがきました。	いったん電源をOFFにして、電源をONにし直してください。POSTの画面で何らかのエラーメッセージが表示されたときは、メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。
		CPU温度の異常を検出しました。	
		PCIシステムエラーがきました。	
		PCIパリティエラーがきました。	
		PCIバスエラーがきました。	
		電圧異常を検出しました。	
		FAN異常を検出しました。	
		センサー故障を検出しました。	
		CPUの温度異常を検出しました。	保守サービス会社に連絡してください。

STATUSランプ1, 2の状態		意味	対処方法
STATUSランプ1	STATUSランプ2		
消灯	アンバー色に点灯	EXPRESSSCOPEエンジン3の一部の機能(インテルノードマネージャー)でエラーが起きました。	保守サービス会社に連絡してください。
消灯	アンバー色に点滅	電源ユニットが故障しています。(冗長時)	保守サービス会社に連絡してください。
		ファンアラームを検出しました。	内部ファンのケーブルが確実に接続されているか確認してください。それでも表示がかわらないときは、保守サービス会社に連絡してください。
		温度警告を検出しました。	内部ファンにホコリやチリが付着していないかどうか確認してください。また、ファンユニットが確実に接続されていることを確認してください。 それでも表示が変わらないときは、保守サービス会社に連絡してください。
		電圧警告を検出しました。	保守サービス会社に連絡してください。
		いずれかのハードディスクドライブが故障しています。(RAID0または非RAID構成時を除く)	保守サービス会社に連絡してください。

4.7.3 LINK/ACT ランプ(図1、図2、図3、図4)

前面にあるLINK/ACTランプは、それぞれのLANポートの状態を示します。

オプションのLOMカードによってポート数は異なります。

LINK/ACTランプの状態	意味
緑色に点灯	ネットワークに正常に接続しています。
緑色に点滅	ネットワークにアクセスしています。
消灯	ネットワークに接続していません。

4.7.4 光ディスクアクセスランプ(オプション)

前面にある光ディスクドライブのアクセスランプは、CDまたはDVDにアクセスしているときに点灯します。

4.7.5 UIDランプ

前面と背面に1個ずつあります。前面または背面にあるUIDスイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。ソフトウェアからのコマンドを受信したときは点滅します。

ラックに搭載された複数のサーバーの中から、特定の装置を識別したいときに使います。特に、ラック背面からメンテナンスするときは、このランプを点灯させておくと対象装置を間違えずに作業できます。

UIDランプの状態	意味
青色に点灯または点滅	UIDスイッチがONの状態です。
消灯	UIDスイッチがOFFの状態です。

4.7.6 Power Capping ランプ

Power Capping ランプは、PowerCapping 機能の有効/無効状態を示します。

Power Capping ランプの状態、その意味は次のとおりです。

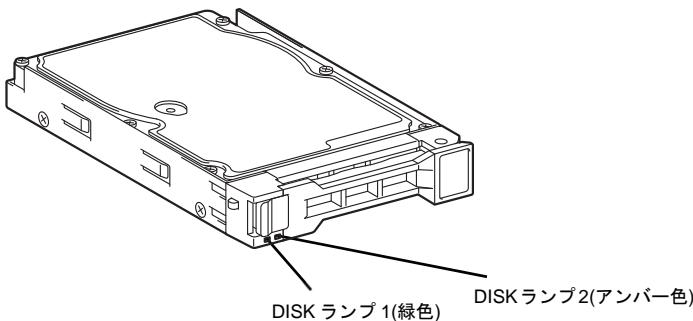
Power Capping ランプの状態	意 味
緑色に点灯	Power Capping機能が有効の状態です。
緑色に点滅	Power Capping機能が有効でかつ、電力制御(Capping)が動作している状態です。
消灯	Power Capping機能が無効の状態です。



STATUS ランプがアンバー点灯/点滅時、Power Capping ランプがアンバー点灯/点滅に見えることがあります。STATUS ランプがアンバー点灯/点滅しているときはハードウェアになんらかの異常が起きたことを示しますので、保守サービス会社に連絡してください。

4.7.7 ハードディスクドライブのランプ

ハードディスクドライブは、ドライブごとに DISK ランプを備えています。



DISKランプ1, 2の状態		意 味	対処方法
DISKランプ1	DISKランプ2		
緑色に点滅	消灯	ハードディスク ドライブにアクセスしています。	—
消灯	アンバー色に点灯 (RAIDシステム構成時のみ)	ハードディスク ドライブが故障しています。	保守サービス会社に連絡してください。
緑色に点滅	アンバー色に点滅 (RAIDシステム構成時のみ)	再構築(リビルド)中です。 RAIDシステムでは、故障したハードディスク ドライブを交換すると自動的にリビルドします(オートリビルド機能)。	—
消灯	消灯	停止しています。	—

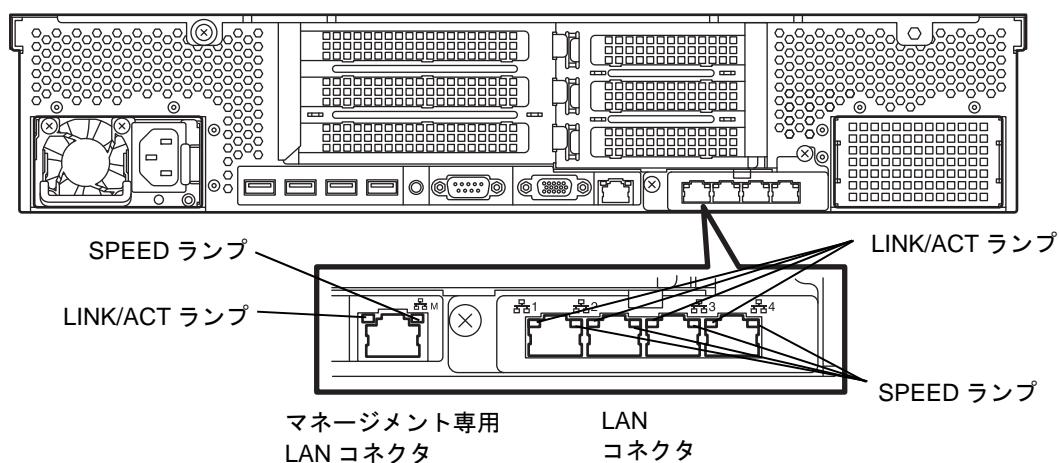


オートリビルド機能を使うときは次の注意事項を守ってください。

- リビルド中は本機の電源 OFF、または再起動しないでください。
- ハードディスク ドライブの取り外し/取り付けの間隔は 90 秒以上空けてください。
- 他のリビルド中のハードディスク ドライブが存在するときは、ハードディスク ドライブを交換しないでください。

4.7.8 LAN コネクタのランプ

LAN コネクタは、それぞれ LINK/ACT ランプ、SPEED ランプを備えています。LOM カードはオプションのため、NE3304-154 実装時を例に示します。



● LINK/ACT ランプ(図1、図2、図3、図4、図M)

LAN ポートの状態を表します。

LINK/ACTランプの状態	意味
緑色に点灯	ネットワークに正常に接続しています。
緑色に点滅	ネットワークにアクセスしています。
消灯	ネットワークに接続していません。

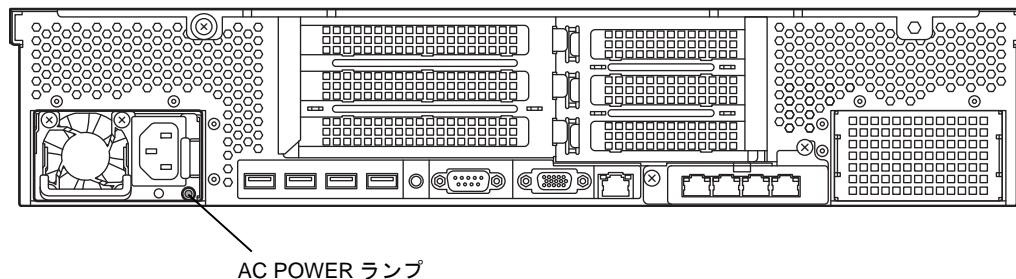
● SPEED ランプ(図1、図2、図3、図4、図M)

LAN ポートの通信モードが、どの規格で動作しているかを示します。

SPEEDランプの状態	意味
アンバー色に点灯	1000BASE-Tで動作しています。
緑色に点灯	100BASE-TXで動作しています。
消灯	10BASE-Tで動作しています。

4.7.9 電源ユニットの AC POWER ランプ

電源ユニットは AC POWER ランプを備えています。



AC POWER ランプ

AC POWERランプの状態	意 味	対処方法
緑色に点灯	本機の電源がONの状態です。	—
緑色に点滅	電源ケーブルが接続されてAC電源を受電している状態です。	—
	コールドリダンダント機能が有効になっています。(→69ページ)	—
アンバー点灯	冗長電源構成で電源ユニットに電源ケーブルが接続されていない状態です。	電源ケーブルを接続してください。
	電源ユニットが故障しています。	保守サービス会社に連絡してください。
アンバー点滅	電源ユニットが故障しています。	保守サービス会社に連絡してください。
消灯	電源が供給されていません。	電源ケーブルを接続してください。 電源ケーブルが接続されている場合は、保守サービス会社に連絡してください。

NEC NX7700x シリーズ NX7700x/A3010E-2

2

準備

本機を使う前に準備することについて説明します。

1. 内蔵オプションの取り付け/取り外し

オプションの取り付け/取り外しの方法と注意事項について説明しています。

オプションを購入していないとき、または「BTO(工場組込み出荷)」でオプションをすべて組み込み指示したとき、ここで説明している手順は省略できます。

2. 設置と接続

本機の設置にふさわしい場所とケーブルの接続について説明しています。

I. 内蔵オプションの取り付け/取り外し

オプションの取り付け/取り外しと注意事項について説明します。

オプションを購入していないとき、または「BTO(工場組込み出荷)」でオプションをすべて組み込み指示したとき、この節(「1. 内蔵オプションの取り付け/取り外し」)で説明している手順は省略できます。



- 弊社認定の保守サービス会社の保守員が作業することをお勧めします。
- オプションおよびケーブルは、弊社が指定する部品を使用してください。指定以外の部品を取り付けた結果、誤動作または故障・破損についての修理は、保証期間内であっても有償になります。

I.1 安全上の注意

安全にオプションの取り付け/取り外しをするため、次の注意事項を必ず守ってください。

警告



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、「安全にご利用いただくために」をご覧ください。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリーやニッケル水素バッテリー、リチウムイオンバッテリーを取り外さない
- 電源プラグを差し込んだまま取り扱わない

注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、「安全にご利用いただくために」をご覧ください。

- 落下注意
- 装置を引き出した状態にしない
- 中途半端に取り付けない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意
- 感電注意

1.2 静電気対策

本機内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け、取り外しの際は、静電気による製品の故障に十分注意してください。

● リストストラップ(アームバンドや静電気防止手袋など)の着用

リストストラップを手首に巻き付け、アース線を接地してから作業してください。リストストラップがないときは、部品を触れる前に接地された筐体の塗装されていない金属表面に触れて身体に蓄積された静電気を放電してください。また、作業中も定期的に金属表面に触れて静電気を放電するようしてください。

● 作業場所の確認

- 静電気防止処理が施された床、またはコンクリートの上で作業してください。
- カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業するときは、静電気防止処理をした上で作業してください。

● 作業台の使用

静電気防止マットの上に本機を置き、その上で作業してください。

● 着衣

- ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業しないでください。
- 静電気防止靴を履いて作業してください。
- 取り付け前に貴金属(指輪や腕輪、時計など)を外してください。

● 部品の取り扱い

- 部品は、本機に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。
- 各部品の縁の部分を持ち、端子や実装部品に触れないでください。
- 部品を保管、運搬するときは、静電気防止用の袋などに入れてください。

● ケーブルの取り扱い

LAN ケーブル等も床面との摩擦によって静電気が帯電することがあります。帯電した状態で接続すると機器を破壊することがあります。接続する前に、除電キット等を使用して除電することを推奨します。

下記の静電気除電キットについては、保守サービス会社にご相談ください。

品名：LAN ケーブル除電治具
型名：SG001(東京下田工業(株)製)

● オプションの取り付け/取り外しについて

- 危険および故障を防止するため、作業時は本機の電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ホットスワップ(活線挿抜)対象製品の取り付け、取り外しは、電源スイッチを OFF にする必要はありません。

オプション製品の取り付け、取り外しは、静電気による製品の故障を防止するため静電気対策用リストストラップなどの装着により静電気を除去してください。また、リストストラップを使用する場合は、接地された箇所にアース線を接続して使用してください。

1.3 取り付け／取り外しの概要

次の手順に従って、部品の取り付け/取り外しをします。

ハードディスクドライブ、ファンユニット、電源ユニットを除く内蔵部品の取り付け/取り外しの作業は、本機をラックから取り外した状態で行います。また、ほとんどの作業は、弊社認定の保守サービス会社にて対応を行い、お客様には、作業前、作業後の確認や設定をご依頼する場合があります。詳細については、以降のオプション毎の説明をご覧ください。

⚠ 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、「安全にご利用いただくために」をご覧ください。

- 落下注意
- 装置を引き出した状態にしない
- カバーを外したまま取り付けない
- 高温注意
- 指を挟まない

1. ラックに搭載しているときは、UIDスイッチを使って作業対象のサーバーを確認します。

本書の「2章(1.4 サーバーの確認(UIDスイッチ))」を参照してください。

2. フロントベゼルを取り付けているときは、フロントベセルを取り外します。

本書の「2章(1.5 フロントベゼルの取り外し)」を参照してください。

3. 電源がONのときは、電源をOFFにします。

本書の「3章(6. 電源のOFF)」を参照してください。

4. 電源コードをコンセントから抜き、本機からも外します。



- 本機から電源コードを取り外した後、30秒以上待ってから作業してください。電源コードを取り外した直後は、冷却ファンなどの部品が動作を続いていることがあります。
- 電源ユニットのAC POWERランプが消灯することを確認してください。

5. 次のオプション以外を取り付け、取り外すときは、本機をラックから取り外し、丈夫で平らな机の上に置きます。本書の「2章(2.1 設置)」を参照してください。

- ハードディスクドライブ
- ファンユニット
- 電源ユニット



本機をラックから引き出したまま放置しないでください。

6. トップカバーを取り外します。
7. PCI ライザーカードを取り外します。
8. サポートバーを取り外します。
9. 取り付け、取り外しする部品に応じて順に作業します。
本書の「2章(1.6 プロセッサー(CPU)～1.14 光ディスクドライブ)」まで参照してください。
10. サポートバーを取り付けます。
11. PCI ライザーカードを取り付けます。
12. トップカバーを取り付けます。
13. ラックへ搭載します。
本書の「2章(2.1 設置)」を参照してください。
14. ハードディスクドライブを取り付けます。
本書の「2章(1.16 ハードディスクドライブ)」を参照してください。
15. 電源ユニットを取り付けます。
本書の「2章(1.17 電源ユニット)」を参照してください。
16. フロントベゼルを取り付けます。
本書の「2章(1.18 フロントベゼルの取り付け)」を参照してください。

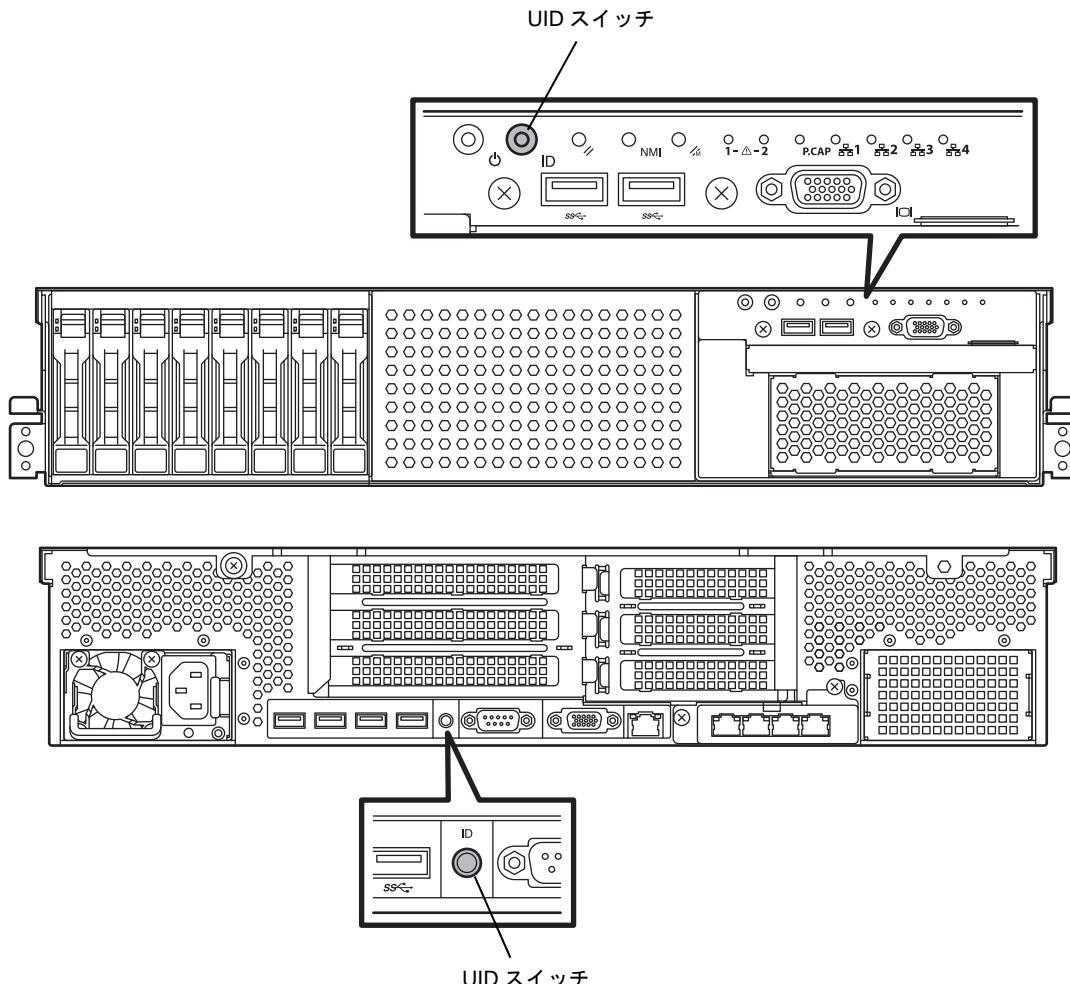
以上で、内蔵オプションの取り付け、取り外しは完了です。
引き続き、本書の「2章(2.2 接続)」を参照して、セットアップを続けてください。

1.4 サーバーの確認(UID スイッチ)

UID(ユニット ID)スイッチを使うと、目的のサーバーがどれか見分けることができます。

本機が運用中のとき、電源を OFF にしたり、ケーブルを外したりする前に、UID スイッチを使って目的のサーバーを確認してから作業するようにしてください。

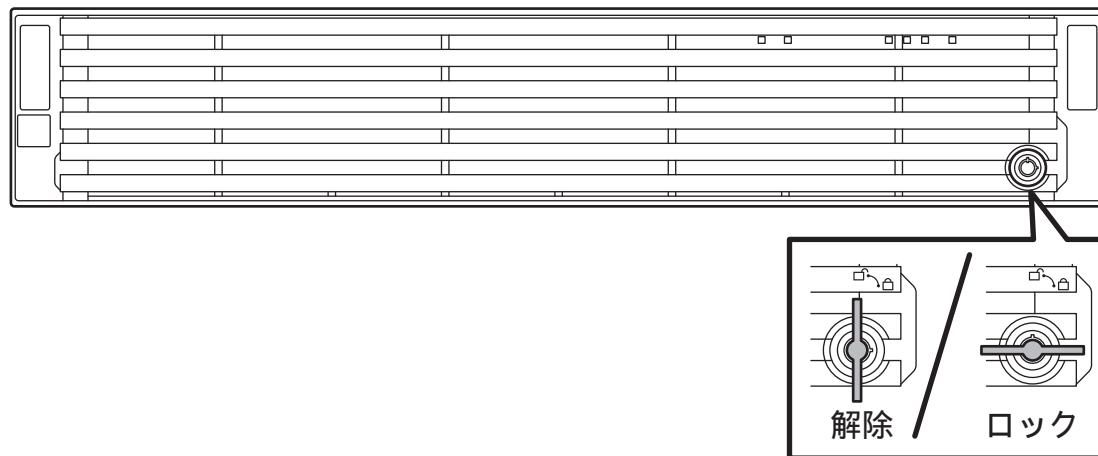
UID スイッチを押すと UID ランプが点灯します。もう一度押すとランプは消灯します。



1.5 フロントベゼルの取り外し

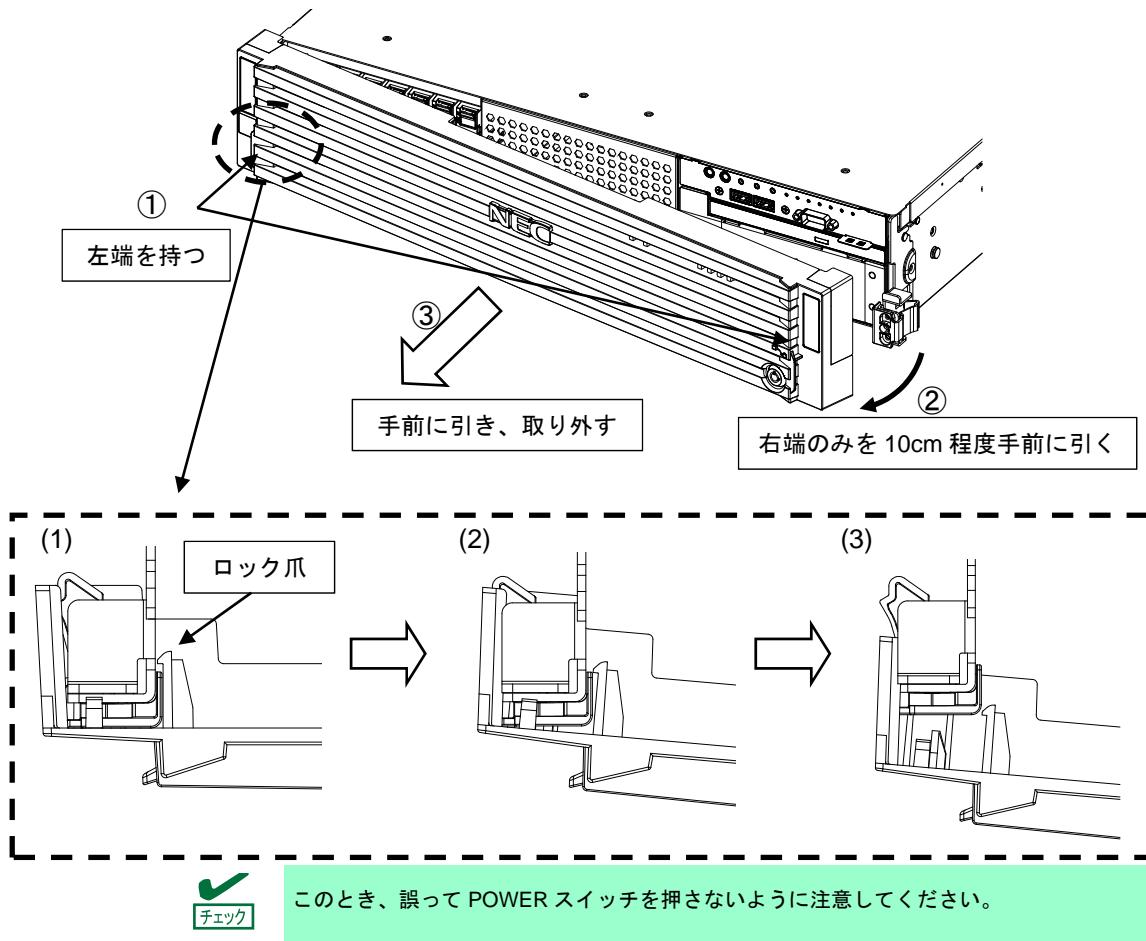
POWER スイッチなどの操作、またはトップカバーを取り外すときは、フロントベゼルを取り外します。

1. キースロットにベゼルロックキーを差し込み、キーをフロントベゼル側に軽く押しながら回して、ロックを解除します。



2. フロントベゼルの左端をしっかりと持ち、右端を持って 10cm 程度手前に引きます。

図のように左側のロックが解除されたことを確認してから左側も手前に引き、装置から取り外します。



1.6 プロセッサー(CPU)

標準搭載のプロセッサー(以降、CPUと呼ぶ)に加えて、もう1つCPUを増設することができます。



- 指定以外のCPUを使用しないでください。サードパーティのCPUなどを取り付けると、CPUだけでなくマザーボードが故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保障期間中でも有償になります。

1.6.1 サポートする最大プロセッサークロア数

本機は、使用可能なプロセッサークロア数(論理プロセッサー数)は下記のとおりです。

本機がサポートする 最大論理プロセッサー数
72

1.6.2 取り付け

弊社認定保守サービス会社の保守員に作業を依頼してください。保守員は、取り付け完了後、電源をONし、正常動作確認後、お客様へ装置をお引渡します。

1.7 DIMM

Dual Inline Memory Module(DIMM)は、マザーボード上の DIMM スロットに取り付けます。マザーボード上には DIMM を取り付けるソケットが 24 個あります。



- 弊社指定以外の DIMM を使用しないでください。サードパーティの DIMM などを取り付けると、DIMM だけでなくマザーボードが故障するおそれがあります。これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は、保証期間中でも有償になります。



DIMM は 2CPU 構成時最大 768GB(32GB × 24 枚)まで、1CPU 構成時最大 384GB(32GB × 12 枚)まで増設できます。

1.7.1 サポートする最大 DIMM 容量

本機は、使用可能な最大の DIMM 容量は下記のとおりです。

本機がサポートする
最大DIMM容量

768GB

1.7.2 メモリクロック

本機は、DDR4-1600/1866/2133MHz のメモリクロック周波数をサポートしておりますが、CPU 構成、DIMM 構成により動作するメモリクロック周波数が異なります(取り付けられたDIMMは、すべて同じクロック周波数で動作します)。

本体型番 (CPU)	メモリ種類	メモリ搭載枚数 (1CPUあたり)	動作周波数
NE3300-201Y (E5-2609v3)	NE3302-611 8GB 増設メモリボード(2x4GB/R) NE3302-612 16GB 増設メモリボード(2x8GB/R) NE3302-613 32GB 増設メモリボード(2x16GB/R)	—	1600 MHz
NE3302-614 64GB 増設メモリボード (2x32GB/LR)	—	1600 MHz	
NE3302-618 16GB 増設メモリボード(2x8GB/R) NE3302-619 32GB 増設メモリボード(2x16GB/R)	—	1600 MHz	
NE3302-622 24GB 增設メモリボード(3x8GB/R) NE3302-623 48GB 増設メモリボード(3x16GB/R)	—	1600 MHz	
NE3300-202Y (E5-2623v3)	NE3302-611 8GB 増設メモリボード(2x4GB/R)	4 セット(8枚)まで	1866 MHz
NE3300-204Y (E5-2640v3)	NE3302-612 16GB 増設メモリボード(2x8GB/R) NE3302-613 32GB 増設メモリボード(2x16GB/R)	5 セット(10枚)以上	1600 MHz
NE3302-614 64GB 増設メモリボード (2x32GB/LR)	4 セット(8枚)まで 5 セット(10枚)以上	1866 MHz 1600 MHz	
NE3302-618 16GB 増設メモリボード(2x8GB/R) NE3302-619 32GB 増設メモリボード(2x16GB/R)	2 セット(4枚)まで 3 セット(6枚)以上	1866 MHz 1600 MHz	
NE3302-622 24GB 増設メモリボード(3x8GB/R) NE3302-623 48GB 増設メモリボード(3x16GB/R)	—	1600 MHz	
NE3300-203Y (E5-2637v3)	NE3302-611 8GB 増設メモリボード(2x4GB/R)	4 セット(8枚)まで	2133 MHz
NE3300-205Y (E5-2643v3)	NE3302-612 16GB 増設メモリボード(2x8GB/R)	—	—
NE3300-206Y (E5-2660v3)	NE3302-613 32GB 増設メモリボード(2x16GB/R)	5 セット(10枚)以上	1600 MHz
NE3300-207Y (E5-2667v3)	NE3302-614 64GB 増設メモリボード (2x32GB/LR)	4 セット(8枚)まで 5 セット(10枚)以上	2133 MHz 1600 MHz
NE3300-208Y (E5-2690v3)	NE3302-618 16GB 増設メモリボード(2x8GB/R)	2 セット(4枚)まで	2133 MHz
NE3300-209Y (E5-2697Y)	NE3302-619 32GB 增設メモリボード(2x16GB/R)	3 セット(6枚)以上	1600 MHz
NE3300-210Y (E5-2699v3)	NE3302-622 24GB 増設メモリボード(3x8GB/R) NE3302-623 48GB 増設メモリボード(3x16GB/R)	—	1600 MHz

1.7.3 メモリ RAS 機能

本機は、次のようなメモリ RAS 機能をサポートしています。このうち、「メモリミラーリング機能」「メモリロックステップ機能(x8 SDDC)」を利用するには、DIMM の増設位置などに特定の条件がありますので、「1.7.6 メモリ機能の利用」を参照し、利用したい機能に応じて条件を確認してください。

- 標準機能(x4 SDDC)*1
- メモリミラーリング機能 (DIMM 構成に条件あり)
- メモリロックステップ機能(x8 SDDC) (DIMM 構成に条件あり)
- メモリスペアリング機能 (DIMM 構成に条件あり)

*1 : NE3302-611 は x4SDDC に非対応

増設メモリボードによりサポートしているメモリ RAS 機能が異なります。

次の一覧で増設メモリボードがサポートしている機能を確認してください。

増設メモリボードがサポートしている機能一覧

Nコード 製品名	標準機能 (x4 SDDC)	メモリミラーリング機能	メモリロックステップ機能 (x8 SDDC)	メモリスペアリング機能
NE3302-611 8GB 増設メモリボード(2x4GB/R)	×	×	×	×
NE3302-612 16GB 増設メモリボード(2x8GB/R)	○	×	×	×
NE3302-613 32GB 増設メモリボード(2x16GB/R)	○	×	×	×
NE3302-614 64GB 増設メモリボード(2x32GB/LR)	○	×	×	×
NE3302-618 16GB 増設メモリボード(2x8GB/R)	×	○	○	×
NE3302-619 32GB 増設メモリボード(2x16GB/R)	×	○	○	×
NE3302-622 24GB 増設メモリボード(3x8GB/R)	×	×	×	○
NE3302-623 48GB 増設メモリボード(3x16GB/R)	×	×	×	○

○ : サポート

× : 未サポート

1.7.4 DIMM の増設順序



メモリ RAS 機能を利用する場合は、メモリボードがサポートしているメモリ RAS 機能一覧をご確認ください。

1CPU 構成時は、DIMM スロット番号の小さい順に 2 枚単位で増設してください。CPU が 1 つのときは、CPU2 側の DIMM スロット(CPU2_DIMM1～CPU2_DIMM12)は使用できません。

2CPU 構成時は、各 CPU の DIMM スロット番号の小さい順に 2 枚単位で 交互に増設してください。

DIMM の増設順序は、DIMM の組み合わせにより異なります。下の組み合わせ一覧から混在可能な DIMM で、容量の大きい DIMM からスロット番号の小さい順に増設してください。

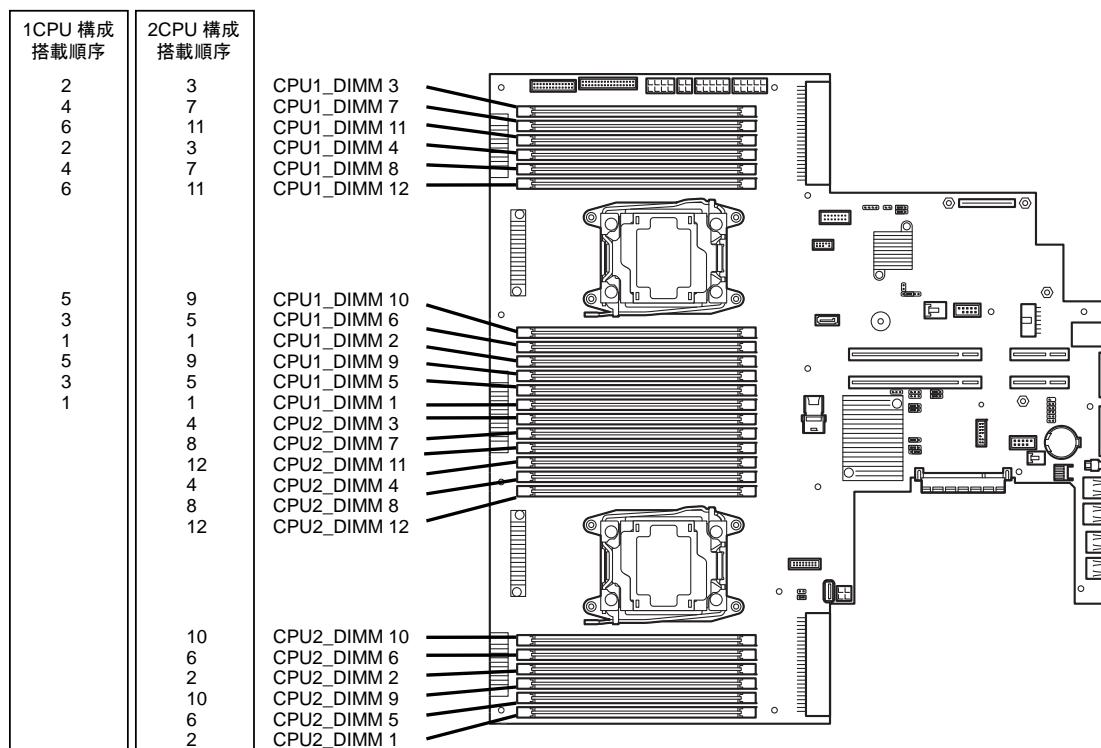
搭載できる DIMM は、組み合わせにより混在ができません。

次の組み合わせのみ混在可能です。

○：混在可

×：混在不可

* : この表に記載された組み合わせ以外は混在不可



1.7.5 取り付け

弊社認定保守サービス会社の保守員に作業を依頼してください。保守員は、取り付け後、電源をONし、正常動作確認後、お客様へ装置をお引渡します。お引渡し後、必要に応じて、OS側の設定を変更してください。詳細は、オペレーティングシステムに付属の説明書を参照するか、保守サービス会社までお問い合わせください。

1.7.6 メモリ機能の利用

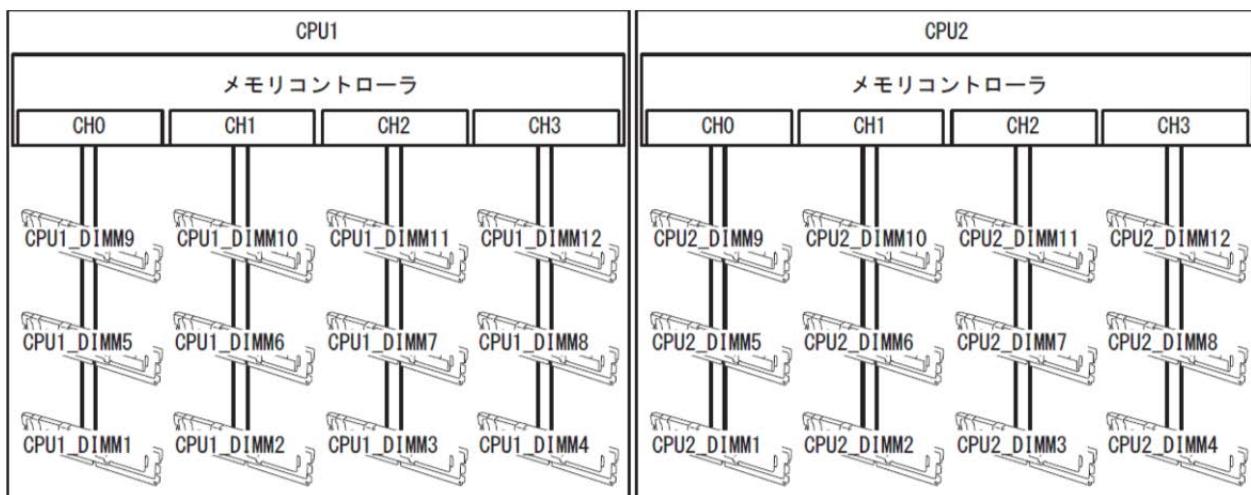
本機は、メモリRAS機能として「標準機能(x4 SDDC)」、「メモリミラーリング機能」、「メモリロックステップ機能(x8 SDDC)」、および「メモリスペアリング機能」を持っています。

Single Device Data Correction (SDDC)は、メモリエラー(複数ビット)を自動的に修正する機能です。



- メモリRAS機能を利用する場合は、1.7.3 メモリRAS機能の増設メモリボードがサポートしている機能一覧をご確認ください。
- 増設メモリボードがサポートしている機能以外はご利用できません。

本機のマザーボードは、メモリを制御するための「メモリチャネル」が4系統に分かれています。



「メモリミラーリング機能」と「メモリロックステップ機能(x8 SDDC)」、「メモリスペアリング機能」は、メモリチャネル間でのメモリの監視と切り替えを行うことによって冗長性を保つ機能です。

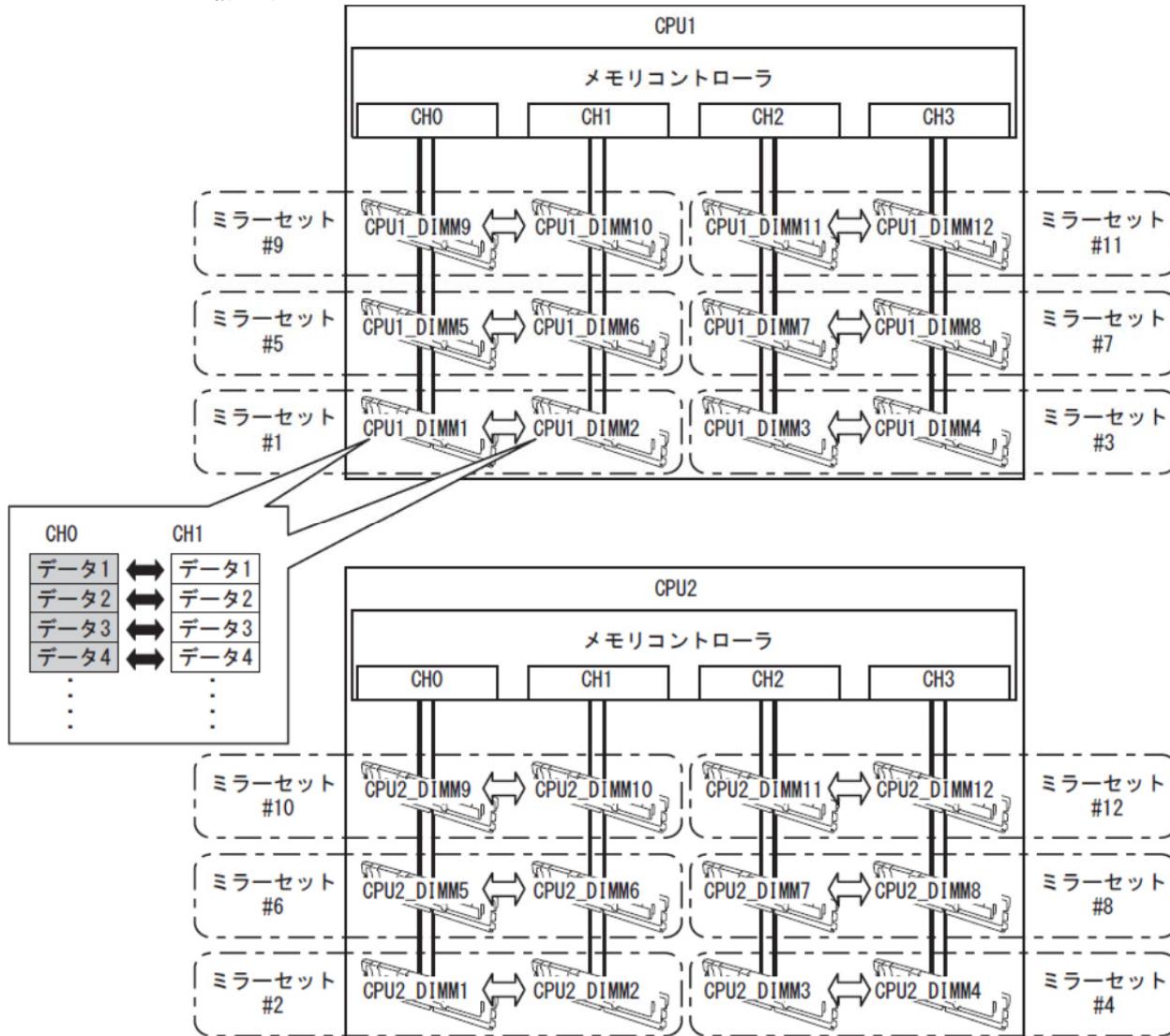
(1) メモリミラーリング機能

メモリミラーリング機能は、2つのメモリチャネル間(チャネル0とチャネル1、チャネル2とチャネル3)で定義したDIMMのグループ(ミラーセット)に同じデータを書き込むことにより冗長性を持たせる機能です。



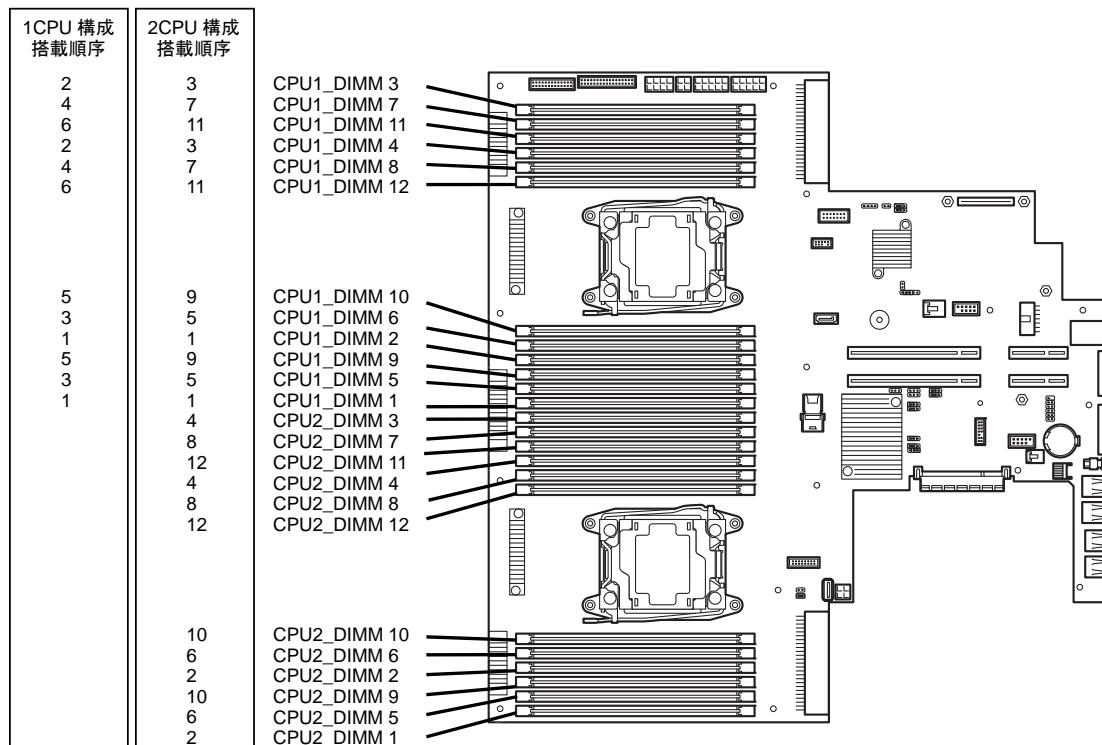
- メモリミラーリング機能はチャネル0とチャネル1、チャネル2とチャネル3を使います。
- メモリミラーリング機能を使うときは、NE3302-618/619増設メモリボード(同一DIMM 2枚セット)を搭載してください。
- ミラーセットには同一型番のDIMMを搭載してください。

例: 2CPU構成時



この機能を利用するための条件は次のとおりです。

- ミラーセットを構成するDIMMソケットにDIMMを搭載してください。
- ミラーセットに搭載するDIMMは同一型番のものを使用してください。
- メンテナンスガイドの「2章(1.システム BIOS)」を参照し、メモリミラー設定できるか確認してください。
Advanced → Memory configuration → Mamory Information で「Mirroring」の項目が「Supported」と表示されていることを確認。
- メンテナンスガイドの「2章(1.システム BIOS)」を参照し、次のパラメーターを変更して設定を保存してください。
Advanced → Memory configuration → Memory RAS Mode を「Mirroring」に変更。
- 再起動後、メンテナンスガイドの「2章(1.システム BIOS)」を参照して次のパラメーターが「Mirrored」と表示されていることを確認してください。
Advanced → Memory configuration → Memory Information の「CPUx_DIMMx Status」の項目に「Mirrored」と表示されていることを確認。
- DIMMはCPU構成により搭載順序が異なります。次の順序で搭載してください。



次のようなミラーリングは構築できません。

- 同一メモリチャネル内のメモリミラーリング

メモリミラー設定に関する注意事項

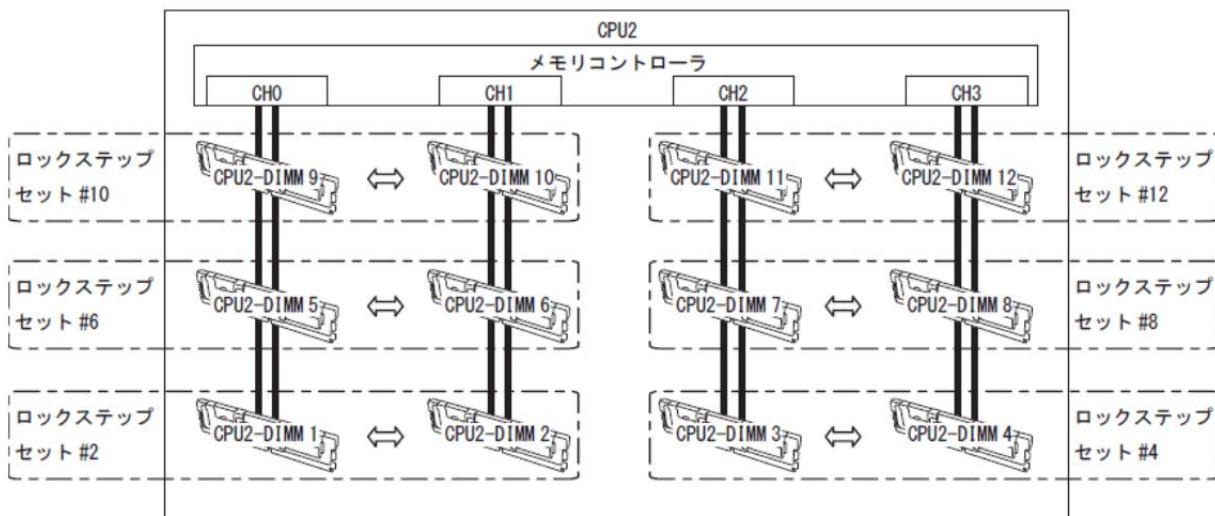
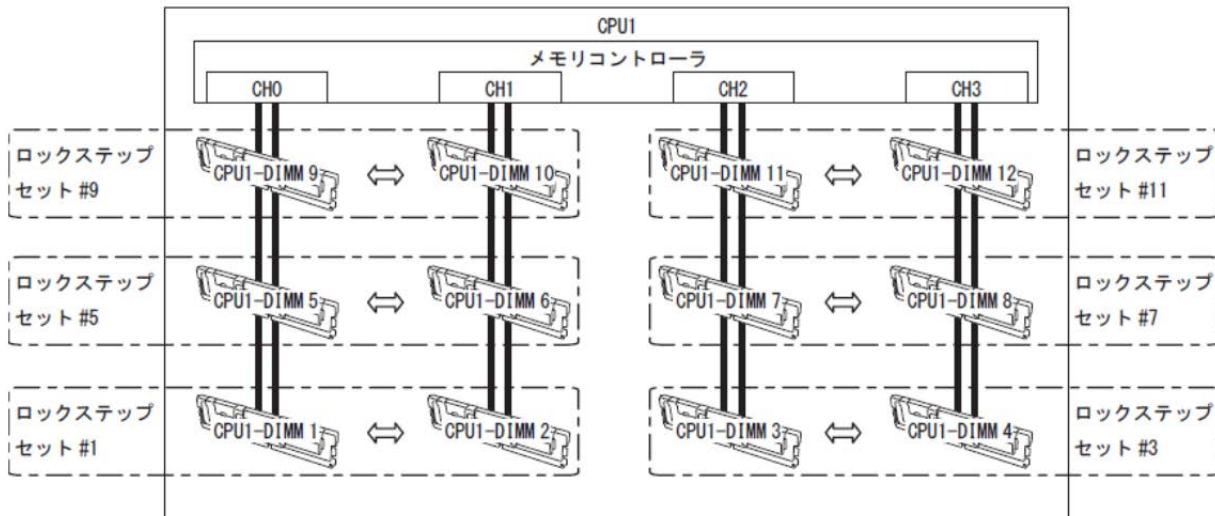
メモリミラーを構築した状態で、メモリミラー構成にならないDIMMの増設や取り外しをした場合、DIMMは「Independent構成」となり、BIOS設定の「Memory Information」に表示される「CPUx_DIMMx Status xxxx MB (Mirrored)」から「Mirrored」が表示されなくなります。

(2) メモリロックステップ機能(x8 SDDC)

メモリロックステップ機能(x8 SDDC)は、2つのメモリチャネル間(チャネル0とチャネル1、チャネル2とチャネル3)で定義したDIMMのグループを多重化させることで、8ビットまでのエラー検出・訂正機能をサポートします。



- メモリロックステップ機能(x8 SDDC)はチャネル0と1、チャネル2と3を使います。
- メモリロックステップ機能(x8 SDDC)を使うときは、NE3302-618/619増設メモリボードを搭載してください。
- ロックステップセットには同一型番のDIMMを搭載してください。



この機能を利用するための条件は次のとおりです。

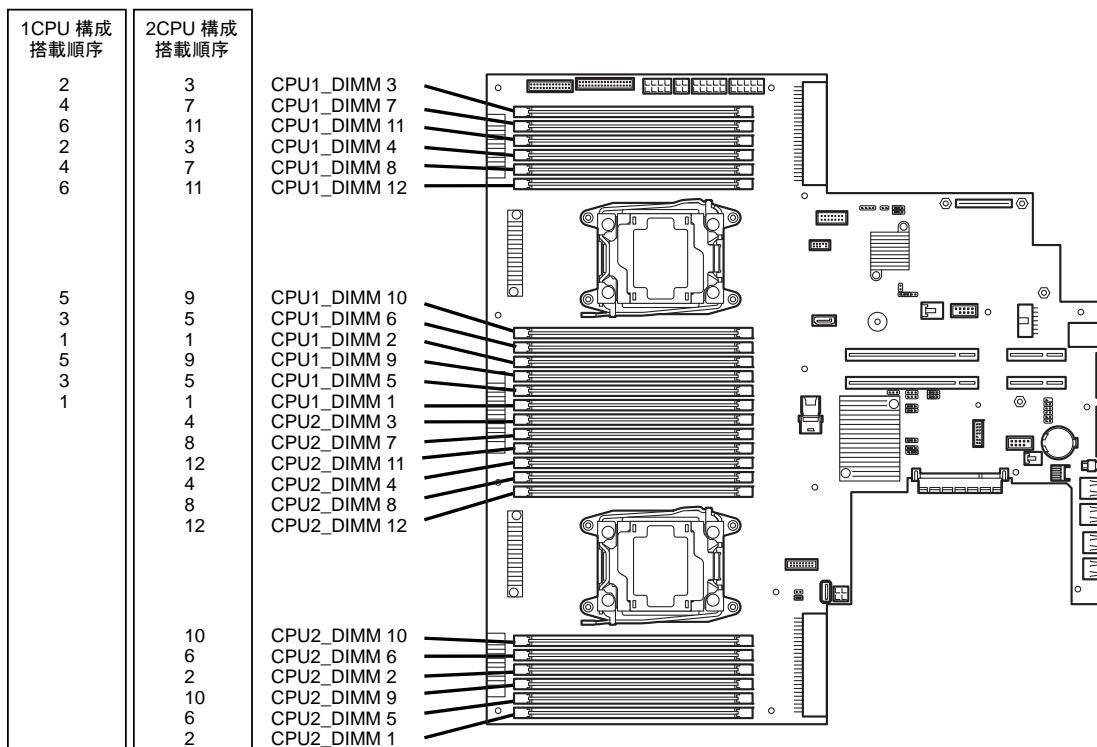
- ロックステップセットを構成するDIMMソケットにDIMMを搭載してください。
- ロックステップセットに搭載するDIMMは同一型番のものを使用してください。
- メンテナンスガイドの「2章(1.システム BIOS)」を参照し、次のパラメーターを変更して設定を保存してください。

Advanced → Memory configuration → Memory RAS Mode を「Lock Step」に変更。

- 再起動後、メンテナンスガイドの「2章(1.システム BIOS)」を参照して次のパラメーターが「Lock Step」と表示されていることを確認してください。

Advanced → Memory configuration → Memory Information の「CPUx_DIMMx Status」の項目に「Lock Step」と表示されていることを確認。

- DIMMはCPU構成により搭載順序が異なります。次の順序で搭載してください。



次のようなロックステップは構築できません。

- 異なるメモリコントローラー(CPU)のメモリチャネルでのメモリロックステップ
- 同一メモリチャネル内のメモリロックステップ

メモリロックステップ設定に関する注意事項

メモリロックステップを構築した状態で、メモリロックステップ構成にならないDIMMの増設や取り外しをした場合、DIMMは「Independent構成」となり、BIOS設定の「Memory Information」に表示される「CPUx_DIMMx Status xxxx MB (Lock Step)」から「Lock Step」が表示されなくなります。

(3) メモリスペアリング機能

メモリスペアリング機能は、各CPUのメモリコントローラー配下にあるメモリチャネルの1つを予備(スペア)として待機させることにより、運用しているメモリチャネル配下のDIMMで訂正可能なエラーが発生した場合、待機させているDIMMに自動的に運用に切り替え、処理を継続させる機能です。



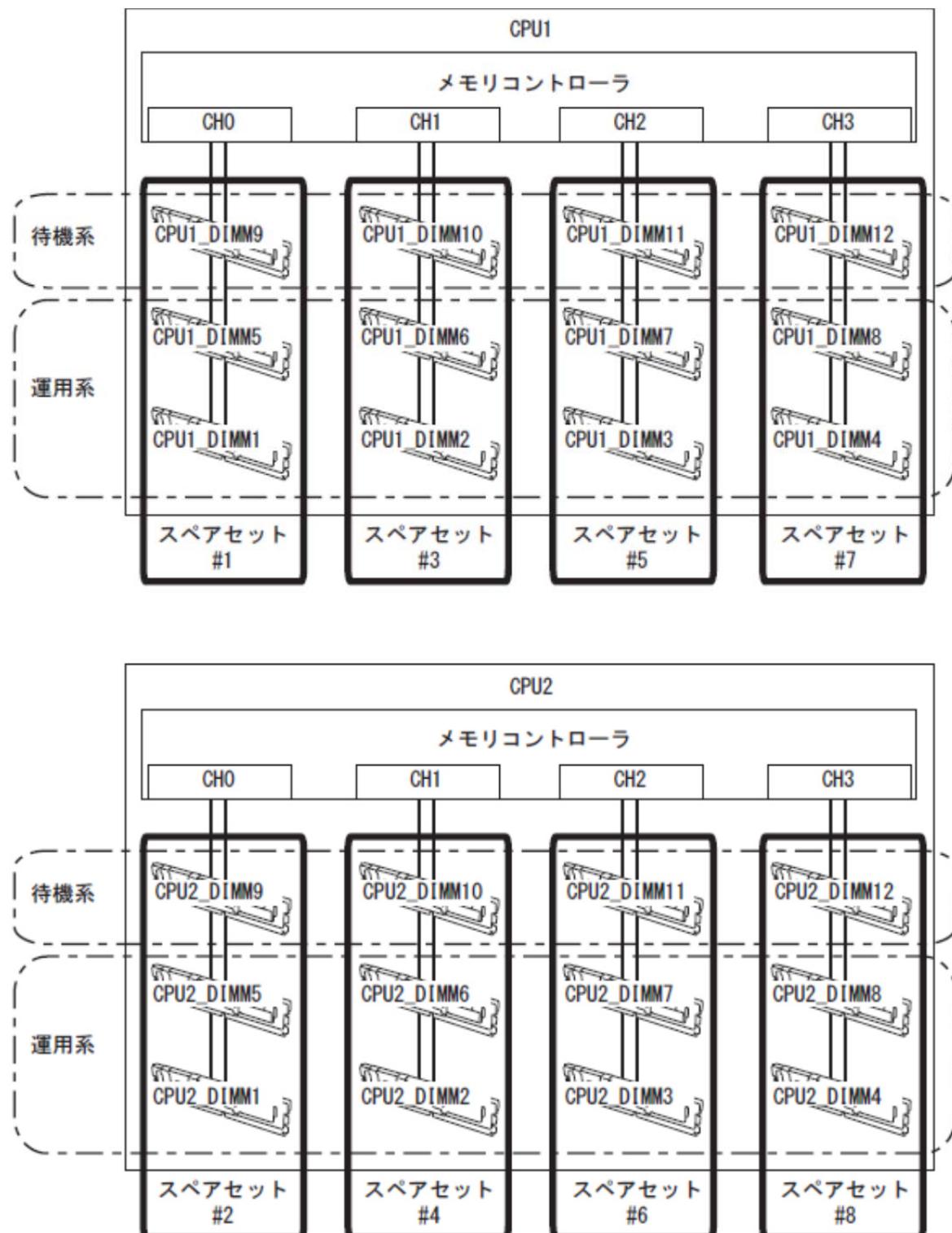
メモリスペアリング機能を使うときは、NE3302-622/623増設メモリボード(同一DIMM3枚セット)を搭載してください。
システム内に搭載するメモリは同一型番のメモリを搭載してください。



オペレーティングシステムからは、実際に搭載したサイズより少なく認識されます(DIMMの搭載数と1枚あたりの容量によって変わります)。

メモリスペアリングをサポートする構成と、その際のシステム論理メモリ容量は次の表を参照してください。

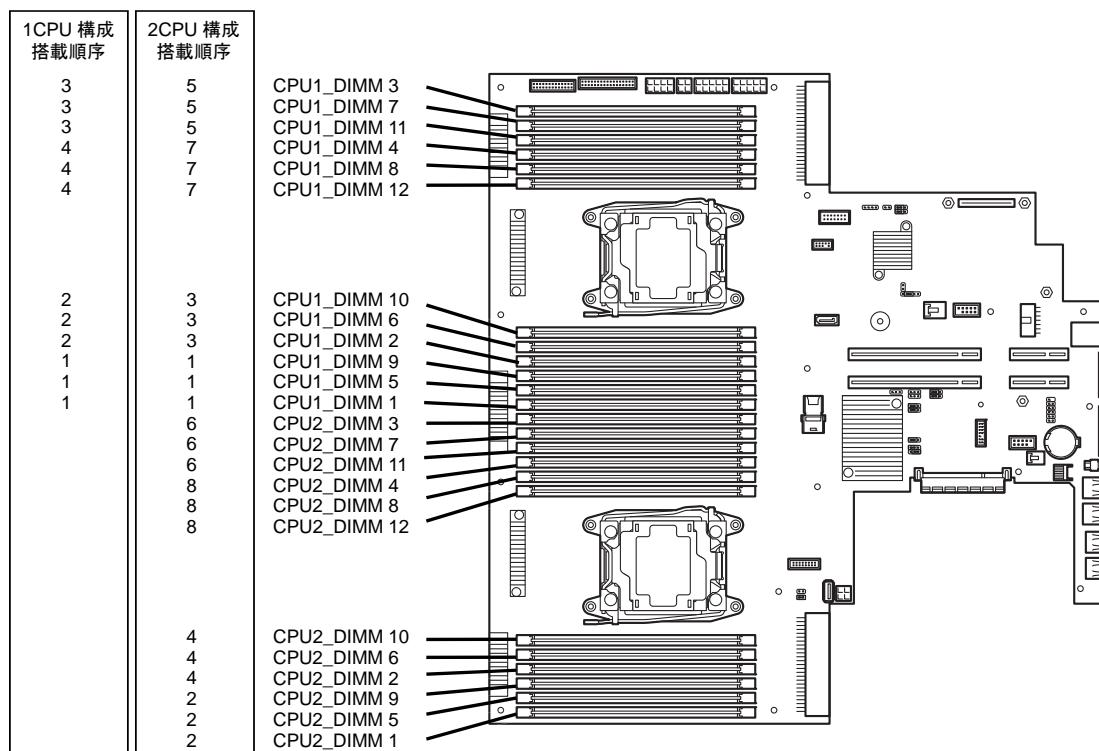
CPU個数	メモリ枚数	搭載メモリ容量	
		8GB	16GB
1個	3枚	16GB	40GB
	6枚	32GB	80GB
	9枚	48GB	120GB
	12枚	64GB	160GB
2個	6枚	32GB	80GB
	12枚	64GB	160GB
	18枚	96GB	240GB
	24枚	128GB	320GB



この機能を利用するための条件は次の通りです。

- スペアセットを構成するDIMMソケットにDIMMを搭載してください。
- スペアリング機能を利用するにはシステム内に搭載するDIMMはすべて同一型番のDIMMを搭載してください。

- メンテナンスガイドの「2章(1.システム BIOS)」を参照し、メモリスペアリング設定ができるか確認してください。
Advanced → Memory configuration → Mamory Information で「Sparing」の項目が「Supported」と表示されていることを確認。
- メンテナンスガイドの「2章(1.システム BIOS)」を参照し、次のパラメーターを変更して設定を保存してください。
Advanced → Memory configuration → Memory RAS Mode を「Sparing」に変更。
- 再起動後、メンテナンスガイドの「2章(1.システム BIOS)」を参照して次のパラメーターが「Spared」と表示されていることを確認してください。
Advanced → Memory configuration → Memory Information の「CPUx_DIMMx Status」の項目に「Spared」と表示されていることを確認。
- DIMM は CPU 構成により搭載順序が異なります。次の順序で搭載してください。



次のようなメモリスペアは構築できません。

- スペアセットに異なる型番の DIMM を搭載
- 異なるメモリチャネル間でのメモリスペアリング

メモリスペアリング設定に関する注意事項

メモリスペアリングを構築した状態で、メモリスペアリング構成にならない DIMM の増設や取り外しをした場合、DIMM は「Independent 構成」となり、BIOS 設定の「Memory Information」に表示される「CPUx_DIMMx Status xxxx MB (Spared)」から「Spared」が表示されなくなります。

1.8 RAID コントローラー用フラッシュバックアップユニット

RAID コントローラー(NE3303-178)を実装するとき、オプションのフラッシュバックアップユニット(以降「FBU」と呼ぶ)を装備することで、Write Back 設定であっても電源断などの不意の事故によるデータ損失を回避できます。

- NE3303-178 用 : 「NE3303-181 フラッシュバックアップユニット」

1.8.1 取り扱い上の注意

FBU を使用するときは、以下について注意してください。これらの注意を無視すると、データやその他の装置が破壊されるおそれがあります。

- それぞれの RAID コントローラーに対応した専用の FBU をご使用ください。
- FBU は大変デリケートな電子装置です。取り付けの前に、本機の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてください。
- FBU を落としたり、ぶつけたりしないでください。
- FBU のリサイクルと廃棄に関しては、RAID コントローラーまたはフラッシュバックアップユニットに添付のユーザーズガイドを参照してください。

1.8.2 NE3303-181 フラッシュバックアップユニットの取り付け

弊社認定保守サービス会社の保守員に作業を依頼してください。保守員は、取り付け後、電源を ON し、正常動作確認後、お客様へ装置をお引渡します。

1.9 LOM カード

本機は、交換可能なオンボードネットワークアダプターである LOM カードをサポートしています。

LOM カードは、マザーボード上の LOM カード専用スロットに取り付けます。マザーボード上には LOM カードを取り付けるスロットが 1 つあります。

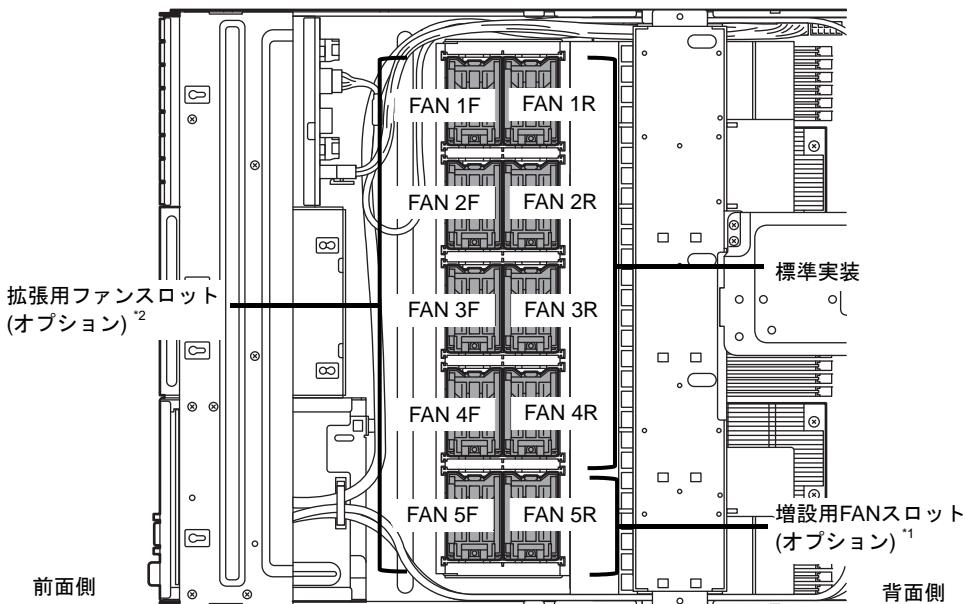
1.9.1 取り付け

弊社認定保守サービス会社の保守員に作業を依頼してください。保守員は、取り付け後、電源を ON し、正常動作確認後、お客様へ装置をお引渡します。

1.10 増設・冗長ファン

本機は拡張冗長ファンをサポートしています。本機のファンは、通電、運用中の状態でも冗長化が可能です(ホットスワップ)。また、本機はCPUを増設したときにもファンを増設します。

次の図は標準装備のファンスロットとオプションのファンスロットおよびそれぞれのスロットに割り当てられているスロット番号を示します。



*1 増設CPUボード搭載時に増設FANを実装するスロット

*2 冗長ファン(拡張用)を実装するスロット

1CPU構成時はFAN 1F~4Fに実装

2CPU構成時はFAN 1F~5Fに実装

1.10.1 取り付け

弊社認定保守サービス会社の保守員に作業を依頼してください。保守員は、取り付け後、電源をONし、正常動作確認後、お客様へ装置をお引渡します。次の手順に従って、ファンを取り付けます。

1.11 バックアップ装置

本機は、磁気テープドライブなどのバックアップ装置をサポートしています。



重要

- 弊社指定以外のバックアップ装置を取り付けないでください。
- 本機に取り付けることができる装置は、幅約 9cm(3.5 インチ)、高さ約 4cm(1.6 インチ)までです。

1.11.1 取り付け

弊社認定保守サービス会社の保守員に作業を依頼してください。保守員は、取り付け後、電源を ON し、正常動作確認後、お客様へ装置をお引渡します。

1.12 PCI ボード

本機は、PCI ボードを取り付けることのできる「ライザーカード(2 種類)」、LOM カードを搭載できる「LOM カード専用スロット」と RAID コントローラーを搭載できる「RAID コントローラー専用スロット」を備えています。ライザーカードにはフルハイト PCI ボードを 3 枚、ロープロファイル PCI ボードを 3 枚、LOM カード専用スロットには、LOM カードを 1 枚、RAID コントローラー専用スロットには RAID コントローラーを 1 枚取り付けることができます。(合計で 8 枚の PCI ボードが搭載可能)。

1.12.1 注意事項

PCI ボードの取り付け/取り外しでは、次の点について注意してください。

- ライザーカードの端子部や電子部品のリード線には直接手を触れないよう注意してください。手の油や汚れが付着し、接続不良を起こしたり、リード線の破損による誤動作の原因となります。
- ライザーカードによって、接続できる PCI ボードのタイプが異なります。ボードの仕様を確認してから取り付けてください。
- 本機には、RAID コントローラーなどにあるディスクアクセス表示用の LED コネクタはありません。
- PCI スロット番号は、RAID コントローラー専用スロットが「1A」、LOM カード専用スロットが「1B」、標準ライザーカードのフルハイト用が下から「1C,2C,3C」、ロープロファイル用が下から「1D,2D,3D」になります。
- 本機の起動時の PCI スロットのサーチ順位は次のとおりです。
1A(RAID コントローラー専用) → 1B(LOM カード) → 1C(フルハイト) → 1D(ロープロファイル) → 2C(フルハイト) → 3C(フルハイト) → 2D(ロープロファイル) → 3D(ロープロファイル)

- OS や RAID コンフィグレーションユーティリティーなどで同種の PCI デバイス(オンボードの PCI デバイス含む)の認識順序が上記サーチ順と異なる場合があります。次の表の PCI バス番号、デバイス番号、機能番号を参照して PCI デバイスのスロット位置を確認してください。

PCIデバイス	PCIバス番号	デバイス番号	機能番号
LOMカードLAN1	05h	0	0
LOMカードLAN2	05h	0	1
LOMカードLAN3	05h	0	2
LOMカードLAN4	05h	0	3
RAIDコントローラー専用スロット 1A	01h	0	X
PCIスロット 1C (フルハイト)	0Ch	0	X
PCIスロット 2C (フルハイト)	81h	0	X
PCIスロット 3C (フルハイト)	A0h	0	X
PCIスロット 1D (ロープロファイル)	40h	0	X
PCIスロット 2D (ロープロファイル)	C0h	0	X
PCIスロット 3D (ロープロファイル)	E0h	0	X

- LAN アダプターを増設した場合、LAN コネクタに接続したケーブルを抜くときは、ケーブルのツメが押しにくくなっているため、マイナスドライバーなどを使ってください。その際、マイナスドライバーなどが LAN コネクタやその他のボードを破損しないよう十分に注意してください。
- ブート可能なデバイス(PCI ボード、USB デバイス等)を追加した場合は、ブート順位が変わることがあります。BIOS 設定の HDD Priorities でブートデバイスの優先順位を確認してください。

[Boot] - [HDD Priorities] → 表示を確認する

また、ブートデバイスがオプションの RAID コントローラー配下の HDD の場合は、(Bus xxDev 00)PCI RAID Adapter がブートデバイスになります(xxの数値は RAID ボードを搭載する PCI スロットにより変わります)。

- RAID コントローラー、LAN アダプター(ネットワークブート)、または Fibre Channel コントローラーで、OS がインストールされたハードディスク ドライブを接続する場合、そのボードのオプション ROM 展開を有効にしてください。設定方法については、本書「3章(2. システム BIOS のセットアップ)」を参照してください。

1.12.2 サポートしているボードと搭載可能スロット

次の表のとおりです。なお、各ボードの機能詳細についてはボードに添付の説明書を参照してください。



同一バス内に異なるボードを実装した場合、または PCI ボードとスロットの動作周波数が異なる場合は低い方の周波数で動作します。

(1) 標準ライザーカード

型名 製品名	スロット番号	#1A	#1B	#1C	#2C	#3C	#1D	#2D	#3D	備考						
	接続CPU	CPU1			CPU2		CPU1	CPU2								
	PCI規格	PCIe 3.0														
	PCIスロット性能 *1 (1レーンあたり)	x8 レーン														
	PCIボードタイプ *2	x8 ソケット														
	スロットサイズ	RAID コント ローラ 専用	LOM カ ード 専用	フルハイイト			ロープロファイル									
	搭載可能な ボードサイズ			220mm 以下	220mm 以下	312mm 以下	220mm以下									
NE3303-178	RAIDコントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6) [PCI Express 3.0(x8)]	○	—	○	—	—	—	—	—	内蔵ディスクとの接続専用 フラッシュバックアップユニット[NE3303-181]を搭載可能						
NE3303-142	SASコントローラ [PCI Express 2.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	外付デバイス装置との接続専用 最大3枚まで搭載可能						
NE3390-159	Fibre Channelコントローラ (8Gbps/Optical) [PCI Express 2.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	外付けFibre Channel接続用						
NE3390-160	Fibre Channelコントローラ (2ch)(8Gbps/Optical) [PCI Express 2.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○							
NE3390-157 A	Fibre Channelコントローラ (16Gbps/Optical) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	外付けFibre Channel接続用 合わせて4枚まで搭載可能 搭載CPUがE5-2609v3の場合、1CPU構成時最大2ポートまで、2CPU構成時最大6ポートまでのカードを搭載可能						
NE3390-158 A	Fibre Channelコントローラ (2ch)(16Gbps/Optical) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○							
NE3304-151	1000BASE-T接続ボード (2ch) [PCI Express 2.0(x1)]	—	—	○	○	○	○	○	○	LAN増設用 カード形状はPCI Express 2.0(x4)						
NE3304-152	1000BASE-T接続ボード (4ch) [PCI Express 2.0(x4)]	—	—	○	○	○	○	○	○	LAN増設用 ブーツ付きLANケーブル使用不可						
NE3304-149	10GBASE 接続基本ボード (SFP+/2ch) [PCI Express 2.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	LAN増設用 SFP+モジュール[NE3304-129]は必要に応じて手配必要 2CPU構成時、[NE3304-156]と合わせて最大5枚まで搭載可能 *3						
NE3304-154	1000BASE-T接続LOMカード(4ch) [PCI Express 2.0(x4)]	—	○	—	—	—	—	—	—	LAN増設用 カード形状はPCI Express 2.0(x8)						
NE3304-156	10GBASE-SFP+(2ch) + 1000BASE-T(2ch) 接続LOMカード [PCI Express 2.0(x8)]	—	○	—	—	—	—	—	—	LAN増設用 SFP+モジュール[NE3304-129]は必要に応じて手配必要 2CPU構成時、[NE3304-149]と合わせて最大5枚まで搭載可能 *3						
NE3703-301	InfiniBand接続ボード(1ch) (FDR/Optical) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	InfiniBand接続用 混在搭載不可 最大2枚まで搭載可能						
NE3703-302	InfiniBand接続ボード(2ch) (FDR/Optical) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○							

● 標準搭載 ○ 搭載可能 — 搭載不可

*1 PCI スロットのデータ転送速度は、転送帯域にレーン数を乗じたものになります。

<例> x8 レーン =64Gbps(片方向)

*2 コネクタサイズを表します。ソケット数以下のカードが接続可能です。

<例>x4 ソケット → x1 カード、x4 カードは搭載可能。x8 カードは搭載不可。

- *3 LAN 性能はご使用のアプリケーション、メモリ性能に依存するため、10G LAN カードを 3 枚以上搭載する場合は、お客様のシステム環境で十分な検証を行った上でご使用ください。
- ・製品名の[]内は、カード自身が持つ最高動作性能です。
 - ・PCI スロットと PCI ボードの動作性能が異なるとき、低い方の性能で動作します。

1.12.3 取り付け

弊社認定保守サービス会社の保守員に作業を依頼してください。保守員は、取り付け後、電源を ON し、正常動作確認後、お客様へ装置をお引渡します。



チェック

- それぞれの PCI ライザーカードがサポートするボードタイプ(ロープロファイルかフルハイ)と取り付ける PCI ボードのタイプを確認してください。
- RAID コントローラ用 FBU を取り付けるときは、「1.8 RAID コントローラ用フラッシュバックアップユニット」を参照してください。



チェック

取り外したブランクカバーは、大切に保管してください。

1.12.4 RAID コントローラの取り付け手順

弊社認定保守サービス会社の保守員に作業を依頼してください。保守員は、取り付け後、電源を ON し、正常動作確認後、お客様へ装置をお引渡します。

RAID コントローラ(NE3303-178)を利用する場合は、RAID コントローラに添付のユーザーズガイドを参照してください。



重要

- RAID システム構築時は、休止状態へ移行しないようにしてください。



チェック

- オプションの RAID コントローラを取り付ける場合は、BIOS セットアップユーティリティーの[Advanced] - [PCI Configuration] - [PCI Slot xx ROM(xx は PCI スロット番号)]が「Enabled」になっていることを確認してください。
- RAID コントローラを接続する場合、BIOS セットアップユーティリティーの Boot メニューにおける優先順位を 8 番目以内に設定してください。設定が 9 番目以降の場合、RAID コントローラのコンフィグレーションメニューが起動できません。

1.13 2.5型 HDD ケージ

本機は、ハードディスクドライブを追加搭載できる「2.5型 HDD ケージ」をサポートしています。

「2.5型増設 HDD ケージ」を使用するためには、RAID コントローラー(NE3303-178)を PCI スロット#1C に実装する必要があります。

1.13.1 取り付け

弊社認定保守サービス会社の保守員に作業を依頼してください。保守員は、取り付け後、電源を ON し、正常動作確認後、お客様へ装置をお引渡します。



チェック

取り外したブランクカバーは、大切に保管してください。

1.14 光ディスクドライブ

オプションの光ディスクドライブを取り付ける手順について説明します。



重要

サポートしていない光ディスクドライブを取り付けないでください。

1.14.1 取り付け

弊社認定保守サービス会社の保守員に作業を依頼してください。保守員は、取り付け後、電源を ON し、正常動作確認後、お客様へ装置をお引渡します。



チェック

取り外したネジとダミーカバーは、大切に保管してください。

1.15 内蔵ハードディスクドライブによる RAID システム

内蔵のハードディスクドライブを RAID システムで利用するときの方法について説明します。



RAID システムに変更するとき、または RAID レベルを変更するとき、ハードディスクドライブを初期化します。ハードディスクドライブに大切なデータがあるときは、バックアップしてから RAID コントローラーの取り付け、RAID システムの構築を行ってください。



RAID システムは、ディスクアレイごとに同じ仕様(同一容量、同一回転数、同一規格)のハードディスクドライブを使ってください。



- 論理ドライブは、ハードディスクドライブが 1 台でも作成できます。
- SAS HDD/SAS SSD を使用する場合、RAID コントローラーとの接続は必須になります。

1.15.1 RAID システム構築時の注意事項

RAID システムを構築するときは、次の点について注意してください。

- 各 RAID レベルで必要となるハードディスクドライブの台数が異なります。

RAID レベル	RAID システム構築に必要となる ハードディスクドライブの最小数
	NE3303-178
RAID 0	1
RAID 1	2
RAID 5	3
RAID 6	3
RAID 10	4
RAID 50	6
RAID 60	6

- RAID 構築を行う場合、同一グループ(パック)内は同一容量/同一種類/同一回転数のハードディスクドライブを使用してください。
- RAID システムに OS をインストールする場合、EXPRESSBUILDER を使ってセットアップすると、RAID の構築から OS のインストールまでを簡単に行うことができます。

- マニュアルでOSをインストールする場合は、RAIDシステムコンフィグレーションユーティリティー(Ctrl-RもしくはHII)を使用します。ユーティリティーの詳細な説明は、「メンテナンスガイド」の「2章(5. RAIDシステムのコンフィグレーション)」や、オプションのRAIDコントローラー(NE3303-178)に添付の説明書を参照してください。



- RAIDシステム構築時は、休止状態、スタンバイへ移行しないでください。
- RAIDシステムは、ディスクアレイごとに同じ仕様(同一容量、同一回転数、同一規格)のハードディスクドライブを使ってください

1.16 ハードディスクドライブ

本機の前面には、ハードディスクドライブを接続するための拡張ベイがあります。

ハードディスクドライブは、専用のトレーに搭載された状態で購入できます。また、トレーに搭載された状態のまま本機に取り付けます。



弊社で指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サードパーティのハードディスクドライブなどを取り付けると、ハードディスクドライブだけでなく本機が故障するおそれがあります。

取り付けるときは、以下に注意してください。

- オンボード接続は非サポートです。
- RAID構築を行う場合、同一グループ(パック)内は同一容量/同一種類/同一回転数のハードディスクドライブを使用してください。

ベイには最大で8台のハードディスクドライブを搭載することができます。

搭載するスロットには固有のスロット番号が割り当てられています。

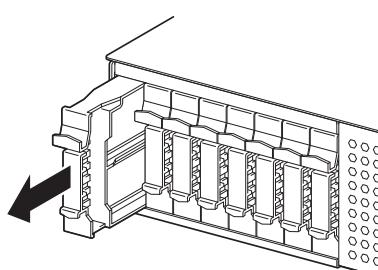
1.16.1 取り付け

次の手順に従ってハードディスクドライブを取り付けます。弊社認定保守サービス会社の保守員に作業を依頼してください。お客様による作業も可能ですが、手順を誤りますと故障等が発生しますので、十分にご注意ください。



RAIDシステムの場合、同じ仕様(同一容量、同一回転数、同一規格)のハードディスクドライブを使用してください。

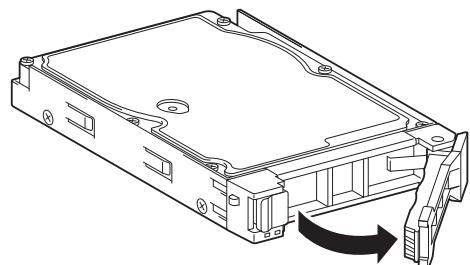
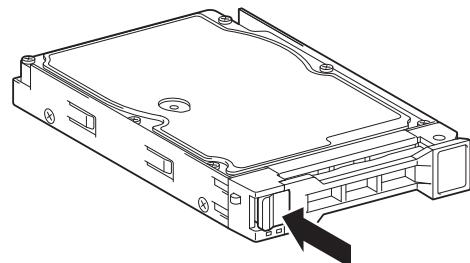
1. 本書の「2章(1.3 取り付け/取り外しの概要)」を参照して準備します。
2. ハードディスクドライブを取り付けるスロットを確認します。
本機には8スロット(2.5型HDDケージを搭載している場合は16スロット)あります。番号の小さい順から取り付けてください。
3. ダミートレーを取り外します。
ダミートレーは全てのスロットに取り付けられています。



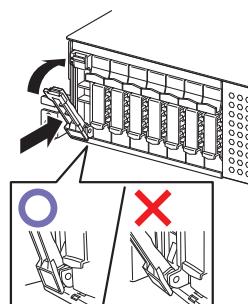


取り外したダミートレーは、大切に保管してください。

4. トレーのハンドルのロックを解除します。



5. トレーをしっかりと持ってスロットへ挿入します。



- ハンドルのフックがフレームに当たるまで押し込んでください。
- トレーは両手でしっかりとていねいに持ってください。

6. ハンドルをゆっくりと閉じます。
「カチッ」と音がしてロックされます。



押し込むときにハンドルのフックがフレームに引っかかっていることを確認してください。

7. BIOS セットアップユーティリティ(SETUP) を起動し、[Boot]メニューで起動順位の設定をします。
詳細は、本書の「3章(2. システム BIOS のセットアップ)」を参照してください。



ハードディスクドライブを増設するとそれまで記憶されていた起動順位の設定がクリアされます。

1.16.2 取り外し

ハードディスクドライブの取り外しは、ハードディスクドライブの取り付けと逆の手順で行ってください。

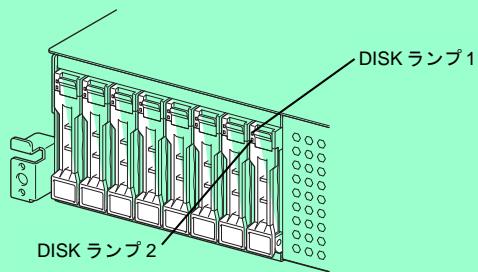
なお、取り外したハードディスクドライブを廃棄または譲渡するときは、「メンテナンスガイド」の「1章(1.譲渡・移動・廃棄)」に従って、お客様の責任において確実にデータを消去してください。



データの消去をしないまま、譲渡(または売却)し、大切なデータが漏洩したとき、弊社ではその責任は負いません。



- 故障のため取り外すときは、DISK ランプ(F)がアンバー色に点灯しているスロットを確認してください。



- ハンドルを持って引き出さないでください。ハンドルが破損するおそれがあります。

BIOS セットアップユーティリティー(SEUP)を起動し、[Boot]メニューで起動順位の設定をします。詳細は、本書の「3章(2. システム BIOS のセットアップ)」を参照してください。



ハードディスクドライブを増設すると、それまで記憶されていた起動順位の設定がクリアされます。

1.16.3 RAID システムでのハードディスクドライブの交換について(オートリビルド)

RAID システムの場合、故障前の状態に戻すオートリビルド機能が使えます。

オートリビルド機能は、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID 50、RAID 60 に設定されている論理ドライブで有効です。

オートリビルドは、故障したハードディスクドライブをホットスワップ(電源 ON の状態での交換)するだけで自動的に行われます。

オートリビルドの間、ハードディスクドライブにある DISK ランプ 1, 2 が、それぞれ緑色点滅もしくはアンバー色点滅します。

オートリビルドを行うときは次の注意を守ってください。

- ハードディスクドライブが故障してからオートリビルドが完了するまで、本機の電源は OFF にしないでください。
- ハードディスクドライブの取り外し/取り付けは、90 秒以上の間隔を空けてください。
- 他にリビルド中のハードディスクドライブがあるときは、ディスクの交換を行わないでください(リビルド中はハードディスクドライブにある DISK ランプ 1, 2 が、それぞれ緑色点滅もしくはアンバー色点滅)。

1.17 電源ユニット

ホットスワップに対応した2台の電源ユニットにより、冗長構成にすることができます(標準では1台)。この場合、電源ユニットが1台故障しても、システムを停止することなく運用を続けることができます。



AC電源ユニットにはACケーブル抜け防止用のケーブルタイを添付しています。

1.17.1 コールドリダンダント機能

本機は次のような電源効率を最適化する機能をサポートしています。

- 電源ユニットが冗長構成のとき、標準側の電源ユニットの稼働効率を上げ、冗長側の稼働率を下げることで最適な電源効率で運用します。
- 構成により、電源ユニットの電源効率が最適化できない場合は、自動的に無効になります。

この機能を利用するための条件は次のとおりです。

- 電源ユニットを冗長構成(2台搭載)にしてください。
- 本書の「3章(2. システム BIOS のセットアップ)」を参照して次のパラメーターを変更し、設定を保存してください。また再起動後、再び SETUP を起動し、[Server]メニュー画面で、「Cold Redundant Mode」のステータスが「Enabled」になっていることを確認してください。

[Server] - [Power Control Configuration] - [Cold Redundant Mode]を[Enabled]へ変更

1.17.2 取り付け

弊社認定保守サービス会社の保守員に作業を依頼してください。保守員は、取り付け後、電源をONし、正常動作確認後、お客様へ装置をお引渡します。



取り外したブランクカバーは、大切に保管してください。

⚠ 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、「安全にご利用いただくために」をご覧ください。

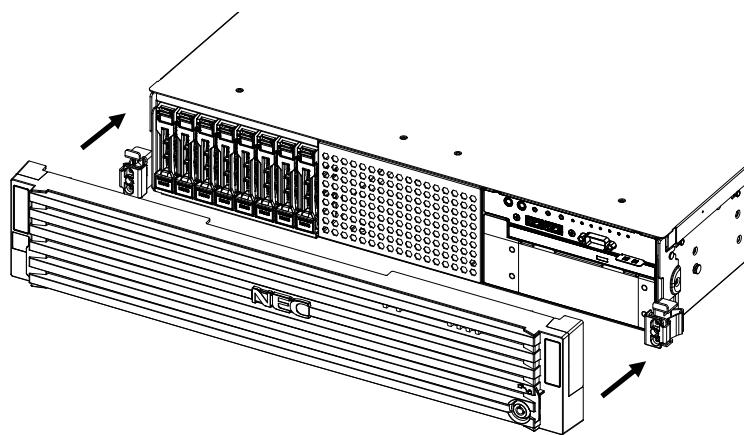
- 感電注意



正常に動作している電源ユニットを取り外さないでください。

1.18 フロントベゼルの取り付け

フロントベゼルを取り付けるときは、上下の向きを合わせ、まっすぐに押し込み装置に取り付けてください。
取り付けた後はキーでロックしてください。(キーでロックしないとフロントベゼルが確実に固定されません)
正しい手順で取り付けない場合、フロントベゼルを破損するおそれがあります。



フロントベゼルの取り付け時に POWER スイッチを押さないよう注意してください。

2. 設置と接続

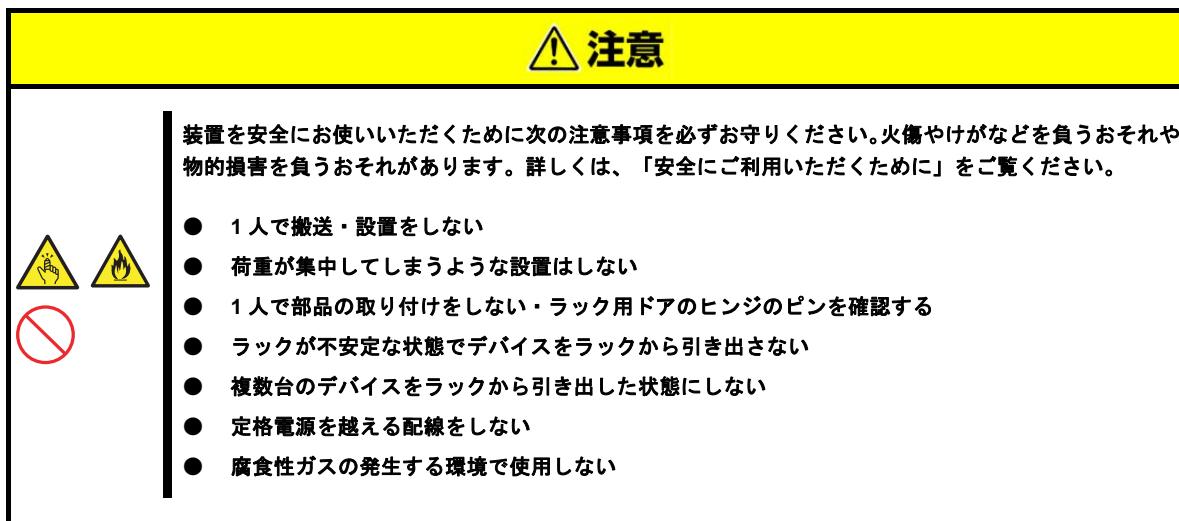
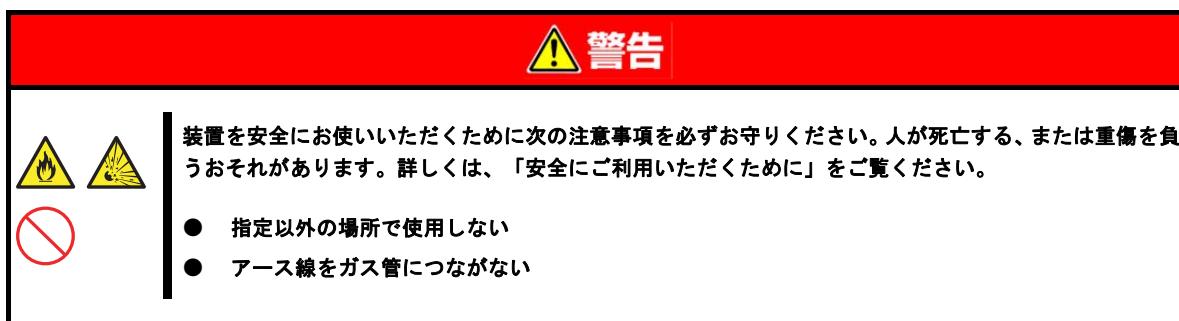
本機の設置と接続について説明します。

2.1 設 置

本機は EIA 規格に適合したラックに取り付けて使用します。

2.1.1 ラックの設置

ラックの設置については、ラックに添付の説明書を参照するか、保守サービス会社にお問い合わせください。ラックの設置作業は保守サービス会社に依頼することもできます。



次のような場所には設置しないでください。誤動作の原因となります。

- 本機をラックから完全に引き出せないような狭い場所。
- ラックや搭載する装置の総重量に耐えられない場所。
- スタビライザーが設置できない場所や耐震工事を施さないと設置できない場所。
- 床におうとつや傾斜がある場所。
- 温度変化の激しい場所(暖房機、エアコン、冷蔵庫などの近く)。
- 強い振動の発生する場所。
- 腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)の存在する場所。また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など)や導電性の金属などが含まれている場所。
- 薬品類の近くや薬品類がかかるおそれのある場所。
- 帯電防止加工が施されていないじゅうたんを敷いた場所。
- 物の落下が考えられる場所。
- 強い磁界を発生させるもの(テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁クレーンなど)の近く(やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールド工事などを行ってください)。
- 本機の電源コードを他の接地線(特に大電力を消費する装置など)と共有しているコンセントに接続しなければならない場所。
- 電源ノイズ(商用電源をリレーなどでON/OFFする場合の接点スパークなど)を発生する装置の近く(電源ノイズを発生する装置の近くに設置するときは電源配線の分離やノイズフィルタの取り付けなどを保守サービス会社に連絡して行ってください)。
- 本機が動作を保証していない環境

2.1.2 ラックへの取り付け/ラックからの取り外し

本機のラックへの取り付け/取り外しについて説明します。



警告



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、「安全にご利用いただくために」をご覧ください。



- 規格外のラックで使用しない
- 指定以外の場所で使用しない



注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、「安全にご利用いただくために」をご覧ください。



- 落下注意
- 装置を引き出した状態にしない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない



ラック内部の温度上昇とエアフローについて

複数台の装置を搭載したり、ラック内部の通気が不十分だったりすると、ラック内部の温度が各装置から発する熱によって上昇し、誤動作するおそれがあります。運用中にラック内部の温度が保証範囲を超えないようラック内部、および室内のエアフローについて十分な検討と対策をしてください。

本機は、前面から吸気し、背面へ排気します

(1) 取り付け手順

本機は弊社および他社製ラックに取り付けることができます。次の手順でラックへ取り付けます。

● ラック搭載前の準備

ラックへ取り付ける前に、レールの確認、取り付けを行います。



レールは左右で形状が異なります。

取り付けを間違った場合、ラックに取り付けることができません。

よく確認して取り付けてください。

● インナーレールの確認

インナーレールの向きを確認します。



インナーレール(L)



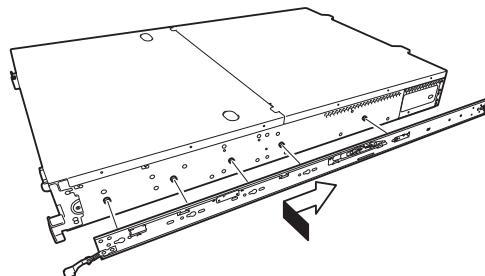
インナーレール(R)

● インナーレールの取り付け

本機の前面から見て左にインナーレール(L)、右にインナーレール(R)を取り付けます。

1. インナーレールを本機側面 3 か所の突起に合わせて、本機背面側にスライドさせます。

このときにインナーレールの中央付近にあるロックが「カチッ」と音がして、ロックされたことを確認してください。



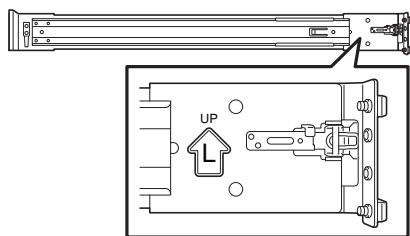
2. 反対側も手順 1 と同様に取り付けます。

● アウターレールの確認

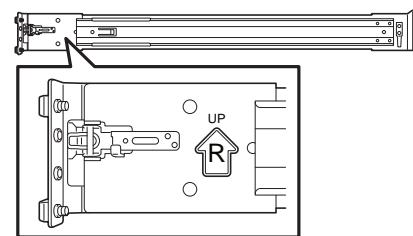
添付のアウターレールの向きを確認します。

アウターレールにある「L」、「R」の刻印を確認してください。

ラックの前面から見て左にアウターレール(L)、右にアウターレール(R)を取り付けます。



アウターレール(L)

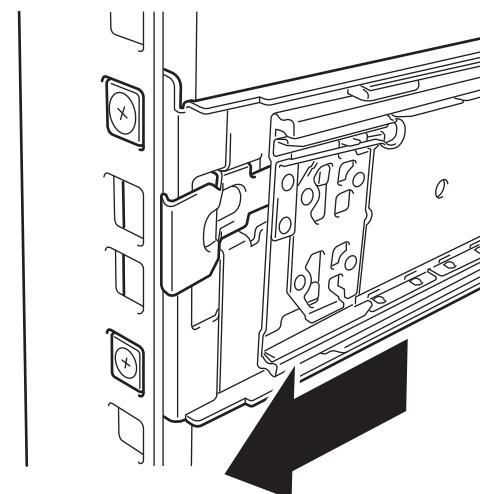


アウターレール(R)

● アウターレールの取り付け

アウターレールの四角い突起を、19型ラックの角穴に入れて取り付けます。この時に「カチッ」と音がして、ロックしたことを確認してください。

右図は左側(前面)を示していますが、左側(背面)、右側(前面/背面)も同様に取り付けます。左右のレールは高さを合わせて取り付けてください。



レールが確実にロックされ、脱落しないことを確認してください。



前後に多少ガタツキがあることがあります、製品に支障はありません。

● 本機の取り付け

⚠ 注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、「安全にご利用いただくために」をご覧ください。



- 1人で持ち上げない
- 落下注意
- 装置を引き出した状態にしない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない

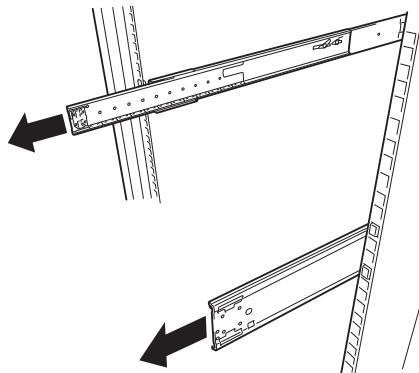
(1) 取り付け手順

次の手順で本機をラックへ取り付けます。

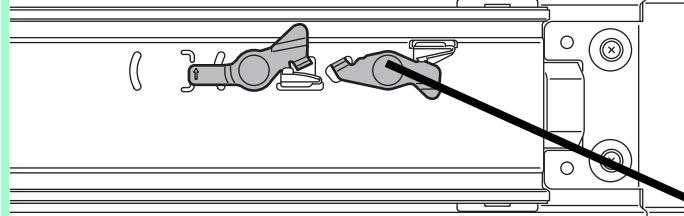


取り付けは2人以上で行ってください。

1. 左右のアウターレールのスライドレールをロックされるまで引き出します。



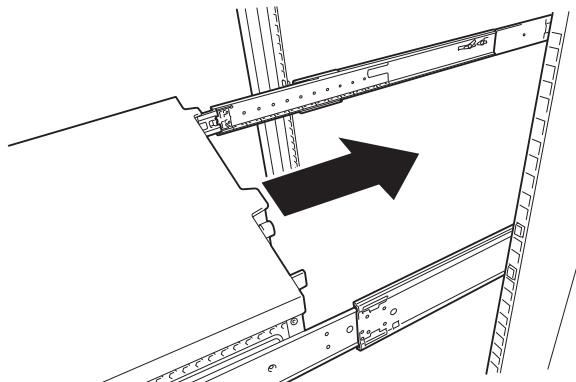
ロック機構が確実にロックしていることを確認してください。



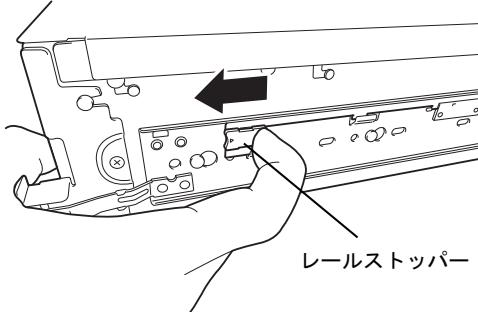
ロック機構

ロック状態

2. 2人以上で本機をしっかりと持ってラックへ取り付けます。



3. 途中で本機がロックされます。引き続き、側面にある青色のスライダー(レールストッパー)を手前に引きながらゆっくりと押し込みます。



レールストッパー

4. 前面のロックが「カチッ」と音がするまで押し込み、本機を固定します。

(2) 取り外し手順

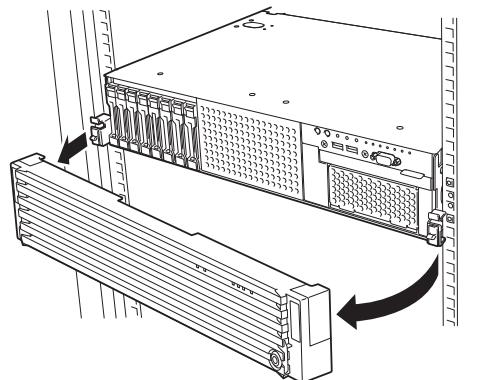
次の手順で本機をラックから取り外します。



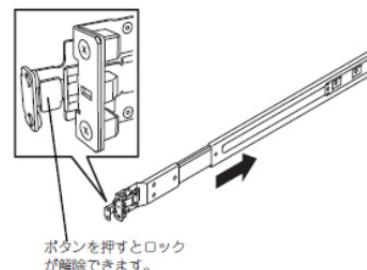
取り外しは2人以上で行ってください。

1. 本機の電源がOFFになっていることを確認し、本機に接続している電源コードやケーブルをすべて取り外します。

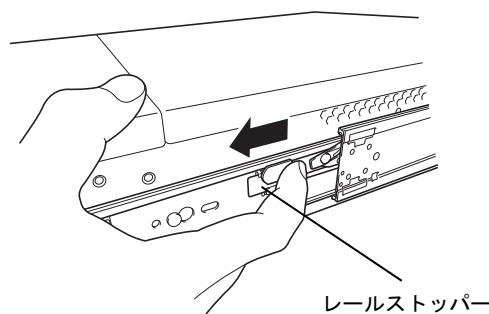
2. フロントベゼルを取り外します。



3. 本機前面の左右にあるボタンを押しながら、本機をゆっくりと静かにラックから引き出します。



4. 本機をラックから引き出すと、途中でロックされます。レール左右の青色のスライダー(レールストッパー)を引きながら、本機をさらに引き出します。



レバーやレールで指を挟まないよう十分に注意してください。

5. 本機をしっかりと持ってラックから取り外します。



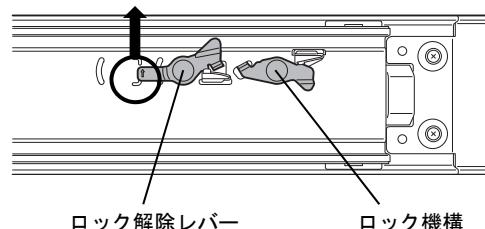
- 複数名で本機の底面を支えながらゆっくりと引き出してください。
- 本機を引き出した状態で、本機の上部に荷重をかけないでください。落下するおそれがあり、危険です。

(3) オウターレールの取り外し

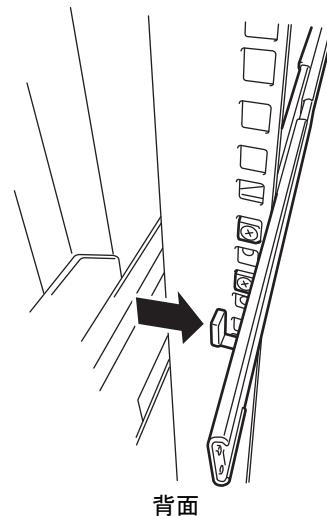
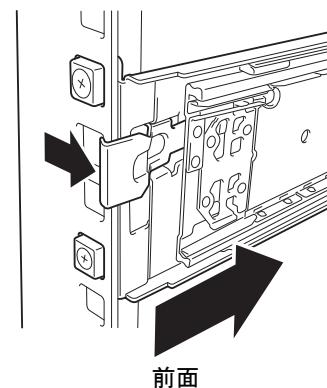
次の手順でオウターレールをラックから取り外します。

1. 本書の「2章(2.1.2 (2)取り外し手順)」を参照し、本機をラックから取り外します。

2. オウターレールのロック解除レバーを矢印の方向に押して解除し、スライドレールを収納します。



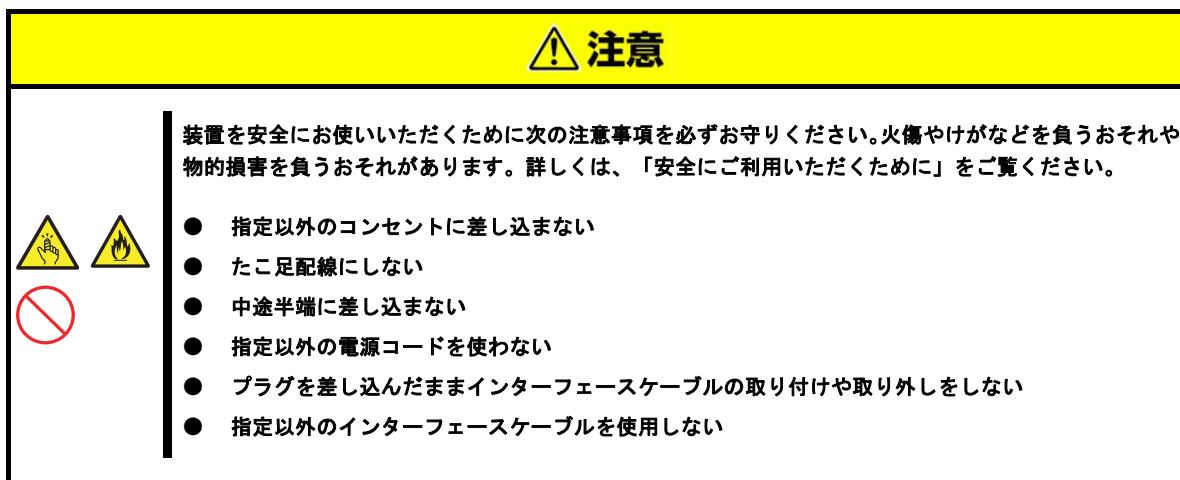
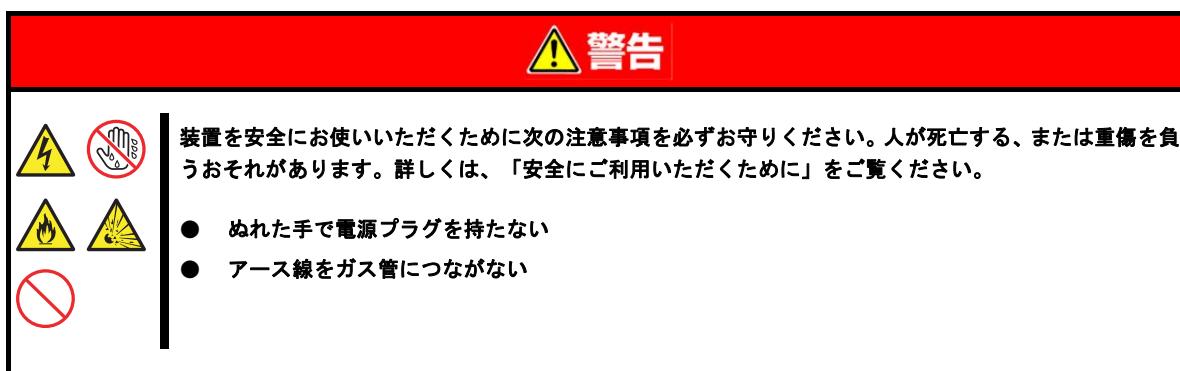
3. オウターレールのレバーを押しながらラック内部へ押して外します。

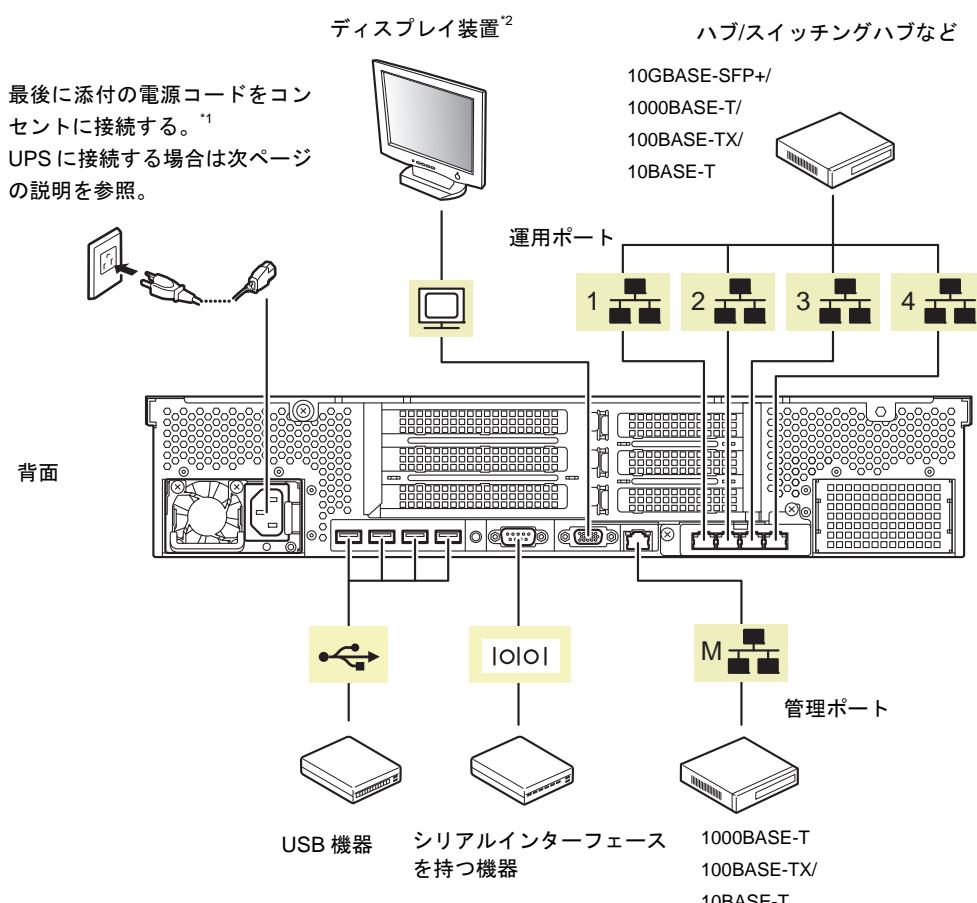
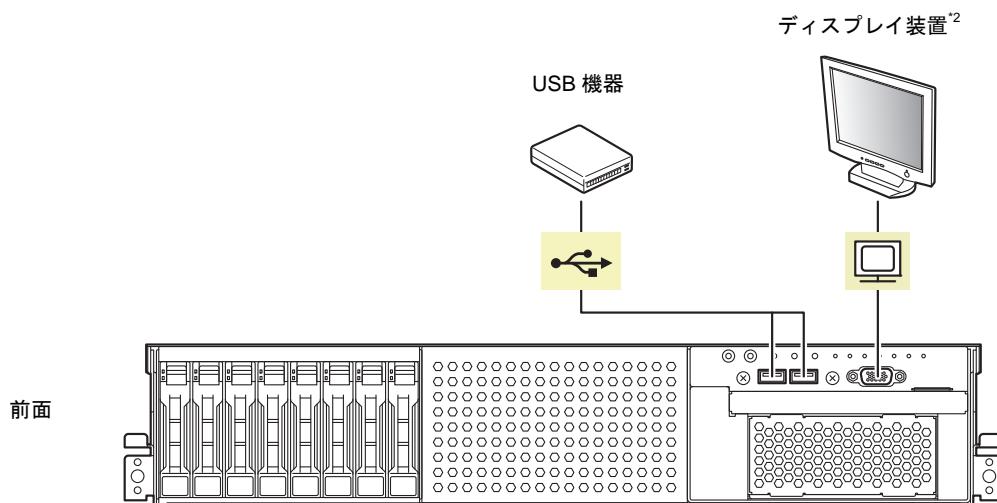


2.2 接 続

本機に周辺装置を接続します。

本機の前面と背面には、さまざまな周辺装置と接続できるコネクタが用意されています。次ページの図は標準の状態で接続できる周辺機器とそのコネクタの位置を示します。





*1 電源コードは、15A 以下のサーキットブレーカーに接続してください。

*2 前面と背面で排他。



回線に接続する場合は、認定機関に申請済みのボードを使用してください。



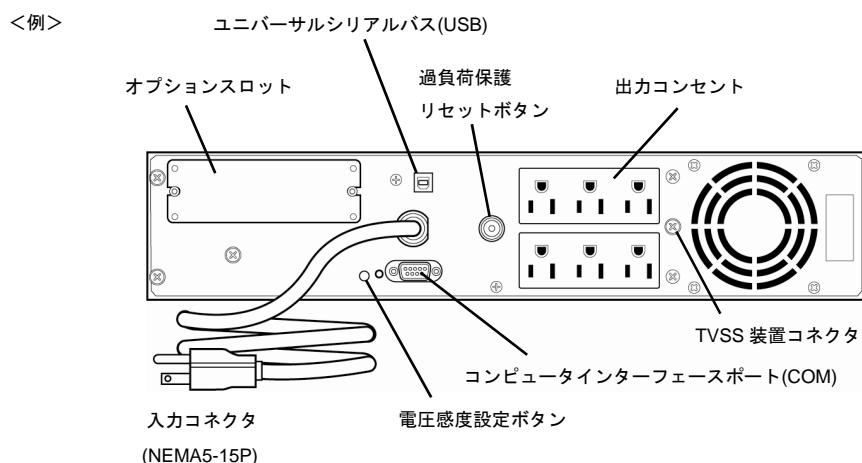
シリアルポートへ専用回線を直接接続することはできません。

接続にあたっては、以下について注意してください。

- プラグアンドプレイに対応していない機器は、電源を OFFにしてから接続してください。
- 弊社以外(サードパーティ)の周辺機器、およびインターフェースケーブルを接続する場合は、お買い求めの販売店で、それらの機器が本機で使用できることをあらかじめ確認してください。
- 電源コードやインターフェースケーブルは、ケーブルタイで固定してください。
- 電源コードのプラグ部分が圧迫されないようにしてください。

2.2.1 無停電電源装置(UPS)への接続について

本機を無停電電源装置(UPS)に接続するときは、UPS の背面にある出力コンセントに電源コードを接続します。詳しくは UPS に添付の説明書を参照してください。



本機の電源と UPS からの電源供給を連動(リンク)させるときは、本機の BIOS 設定を変更してください。

[Server]-[AC-LINK]で設定することができます。UPS を利用した自動運転を行う場合は、[Power On]を選択してください。詳しくは、本書の「3章(2. システム BIOS のセットアップ)」を参照してください。

3

NEC NX7700x シリーズ NX7700x/A3010E-2

セットアップ

本機のセットアップについて説明します。

1. 電源のON

本機の電源をONにする手順です。

2. システムBIOSのセットアップ(SETUPの説明)

BIOSの設定方法について説明しています。

3. EXPRESSSCOPEエンジン 3

本機に搭載しているEXPRESSSCOPEエンジン 3について説明しています。

4. EXPRESSBUILDER

EXPRESSBUILDERについて説明しています。

5. ソフトウェアのインストール

OS、バンドルソフトウェアのインストールについて説明しています。

6. 電源のOFF

本機の電源をOFFにする手順です。

I. 電源の ON

本機の電源は、前面の POWER スイッチを押すと ON の状態になります。

次の順序で電源を ON にします。



電源を OFF にした後は、POWER スイッチを押すまでに 30 秒以上の時間を空けてください。

1. ディスプレイと周辺機器の電源を ON にします。



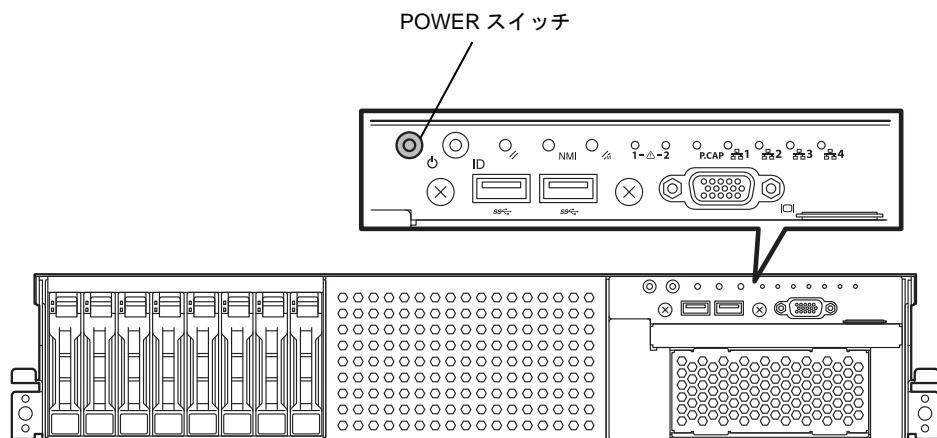
無停電電源装置(UPS)などの電源制御装置と電源コードを接続しているときは、電源制御装置の電源が ON になっていることを確認してください。

2. フロントベゼルを取り外します。
3. STATUS ランプが緑色／アンバー色に点灯しているときは、消灯するまで待ちます。
4. 前面の POWER スイッチを押します。

POWER ランプが緑色に点灯し、しばらくするとディスプレイに「ロゴ」が表示されます。



POST 中に外付け USB デバイスを接続したり、外したりしないでください。



「NEC」ロゴを表示している間、自己診断機能(POST)が動作してハードウェアを診断します。詳しくは、本書の「3章(1.1 POST のチェック)」をご覧ください。

1.1 POST のチェック

Power On Self-Test (POST)は、本機に標準装備されている自己診断機能です。POST は、本機の電源を ON になると自動的に実行し、マザーボード、DIMM、プロセッサー(CPU)などをチェックします。また、POST の実行中は、各種ユーティリティーの起動メッセージなども表示します。

通常は、POST の内容を確認する必要はありません。次のようなとき、POST で表示されるメッセージを確認してください。

- 導入時
- 「故障かな？」と思ったとき
- 電源 ON から OS 起動の間に何度もビープ音がしたとき
- ディスプレイになんらかのエラーメッセージが表示されたとき

1.1.1 POST の流れ

次に、POST のチェックについて、順を追って説明します。

1. 本機の電源を ON にすると、POST が始まり、ディスプレイに初期化メッセージが表示されます。これはメモリや PCI デバイスなどの初期化を知らせるメッセージです。初期化メッセージが表示された後に、ロゴが表示されます。



- キーボードはロゴを表示した後に操作できるようになります。
- 初期化メッセージが表示される間、何も表示されない画面（黒い画面）に何度か切り替わる場合があります。動作に問題ありません。
- オプション VGA コントローラーが接続された場合や、BIOS セットアップユーティリティー(SETPUP)の設定によって、ロゴや初期化メッセージが表示されない場合があります。
- 初期化メッセージは、シリアルポートのコンソールリダイレクション画面では表示されません。

2. BIOS セットアップユーティリティー(SETPUP)で「Security」メニューの「Password On Boot」を [Enabled] にすると、ロゴが表示された後にパスワードを入力する画面が表示されます。パスワード入力を連続して 3 回誤ると POST を停止します(これより先の操作を行えません)。この場合、いったん本機の電源を OFF にして、再び電源を ON してください。



OS をインストールするまではパスワードを設定しないでください。

3. <Esc>キーを押すとロゴが消え、POST の内容が表示されます。これらは搭載している CPU やメモリ容量などを知らせるメッセージです。



BIOS セットアップユーティリティー(SETPUP)で「Boot」メニューの「Quiet Boot」を [Disabled] にすると、ロゴを表示せず POST の内容が表示されます。

4. しばらくすると、次のようなメッセージが画面に表示されます。（※環境によってメッセージが変わります）

Press <F2> SETUP, <F3> Internal Flash Memory, <F4> ROM Utility, <F12> Network

メッセージに従ってファンクションキーを押すと、POST 終了後に、次のような機能が起動します。

<F2>キー： BIOS セットアップユーティリティ(SETUP)を起動します。本書の「3章(2. システム BIOS のセットアップ(SETUP の説明))」を参照してください。

<F3>キー： 内蔵フラッシュメモリから EXPRESSBUILDER を起動します。本書の「3章(4. EXPRESSBUILDER」を参照してください。



- <F3>キーはメッセージを表示してから、5秒間キー入力を受け付けます。
- <F3>キーを押しても、起動可能な CD/DVD が光ディスクドライブに入っているときは、CD/DVD から起動します。

<F4>キー： オフラインツールを起動します。「メンテナンスガイド」の「1章(9. オフラインツール)」を参照してください。

<F12>キー： ネットワークから起動します。



BIOS セットアップユーティリティ(SETUP)で「Server」メニューの「Power Measurement Policy」を[One time]、または、[Always]にすると、上記メッセージに代わり、電力測定中のメッセージが表示されます。測定が完了するまで、しばらくお待ちください。

5. POST が終了すると OS を起動します。

1.1.2 POST のエラーメッセージ

POST 中にエラーを検出すると、ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。エラーの内容によってはビープ音でエラーが起きたことを通知します。エラーメッセージの意味、その原因、および対処方法については、「メンテナンスガイド」の「3章(1. POST 中のエラーメッセージ)」を参照してください。



保守サービス会社に連絡するときは、ディスプレイの表示を記録しておいてください。エラーメッセージは保守を行うときに有用な情報となります。

2. システム BIOS のセットアップ(SEUP の説明)

Basic Input Output System (BIOS)の設定について説明します。ここで説明する内容をよく理解して、正しく設定してください。

2.1 概要

BIOS セットアップユーティリティー(SEUP)は、本機の BIOS を設定するためのユーティリティーです。このユーティリティーは本機のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、起動用のメディアがなくても実行できます。

BIOS は、あらかじめ最適な状態に設定して出荷していますので、ほとんどの場合において SEUP を使用する必要はありません。本書の「3章(2.4 設定が必要なケース)」に記載のケースに該当するときのみ使用してください。

2.2 起動

本書の「3章(1.1.1 POST の流れ)」に従って POST を進めます。

しばらくすると、次のようなメッセージが画面下に表示されます(※環境によってメッセージが変わります)。

Press <F2> SETUP, <F3> Internal Flash Memory, <F4> ROM Utility, <F12> Network

ここで<F2>キーを押すと、POST 終了後に SEUP が起動して「Main」メニューが表示されます。

パスワードを設定した場合、パスワード入力を促すメッセージが表示されます。

Enter password []

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも誤ったパスワードを入力すると、動作を停止します。

これ以上は操作できませんので、電源を OFF にしてください。

SEUP の設定を保存する場合、「Save & Exit」メニューの[Save changes and Exit]にて終了します。

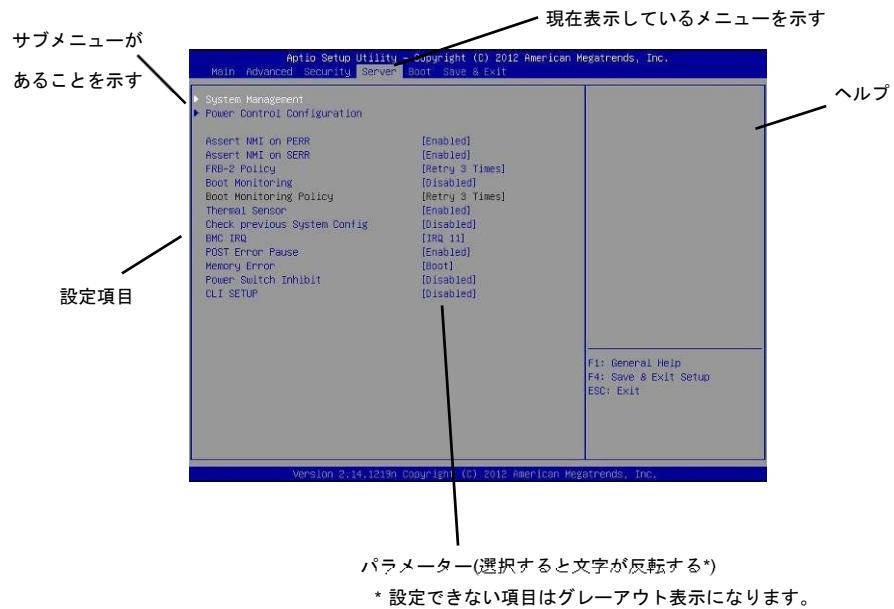
変更を破棄する場合、「Save & Exit」メニューの[Discard changes and Exit]にて終了します。



- 設定をデフォルト値に戻すときは、「Save & Exit」メニューの[Load Setup Defaults]を選択してください。
- デフォルト値は、出荷時の設定と異なることがあります。
- 「Advanced」メニューの「iSCSI Configuration」サブメニュー、および、「UEFI Driver Configuration」サブメニューの値はデフォルト値に戻りません。

2.3 キー操作と画面の説明

画面の表示例と操作方法について説明します。SETUP は、キーボードを使って操作します。



パラメーター(選択すると文字が反転する*)
 * 設定できない項目はグレーアウト表示になります。

□ カーソルキー(<↑>、<↓>)

項目を選択します。現在選択されている項目は反転表示になります。

□ カーソルキー(<←>、<→>)

[Main]、[Advanced]、[Security]、[Server]、[Boot]、[Save & Exit]のトップメニューを選択します。

□ <→>キー／<+>キー

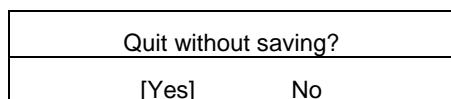
選択している項目の値(パラメーター)を変更します。サブメニュー(項目の前に「▶」がついているもの)を選択しているとき、このキーは無効です。

□ <Enter>キー

選択したパラメーターを決定するときに押します。

□ <Esc>キー

ポップアップ画面をキャンセルします。サブメニューでは一つ前の画面に戻ります。トップメニューでは以下の画面が表示されます。[Yes]を選択すると、変更した項目のパラメーターを元の設定に戻して SETUP を終了します。



□ <F1>キー

キー操作のヘルプが表示されます。SETUP の操作でわからないことがあったときはこのキーを押してください。<Esc>キーを押すと、元の画面に戻ります。

□ <F2>キー

このキーを押すと以下の画面が表示されます。[Yes]を選択すると、変更した項目のパラメーターを元の設定に戻します。

Load Previous Values?	
[Yes]	No

□ <F3>キー

このキーを押すと以下の画面が表示されます。[Yes]を選択すると、SETUP のパラメーターをデフォルトの設定に戻します(出荷時の設定と異なるときがあります)。

Load Setup Defaults?	
[Yes]	No



「Advanced」メニューの「iSCSI Configuration」サブメニュー、および「UEFI Driver Configuration」サブメニューの値はデフォルト値に戻りません。

□ <F4>キー

このキーを押すと以下の画面が表示されます。[Yes]を選択すると、設定したパラメーターを保存してSETUP を終了します。終了後、本機は自動的に再起動します。

Save configuration and exit?	
[Yes]	No

2.4 設定が必要なケース

次のようなケースに該当するとき、SETUP を操作して出荷時の設定からパラメーターを変更してください。それ以外のときは、出荷時の設定で運用してください。SETUP のパラメーター一覧、および出荷時の設定については、「メンテナンスガイド」の「2章(1. システム BIOS)」に記載しています。

(1/2)

カテゴリー	ケース	設定内容	備考
基本設定	日付・時刻を変更する	[Main] - [System Date]で日付を設定してください [Main] - [System Time]で時刻を設定してください	OSからも設定できます
	電源ON時のNumLockをオンに設定する	[Boot] - [Bootup Numlock State]を[On]に設定してください	
	POST中のロゴを非表示にする	[Boot] - [Quite Boot]を[Disabled]に設定してください	POST中に<ESC>キーを押してロゴを一時的に非表示にすることもできます
メモリ関連	DIMMを増設/変更した後にメモリを再構成する。	[Advanced] - [Memory Configuration] - [Memory Retest]を[Yes]に設定してください	[Memory Retest]は[Yes]に変更後、再起動すると自動的に[No]に戻ります
	メモリRAS機能を使う	[Advanced] - [Memory Configuration] - [Memory RAS Mode]を設定してください	メモリの構成によっては選択したRAS機能が利用できないことがあります
オプションボード	取り付けたオプションボードから起動する	[Advanced] - [PCI Configuration] - [PCI Device Controller and Option ROM Settings] - [PCI Slot Option ROM] を[Enabled]に設定してください	xxは、取り付けたオプションボードのPCIスロット番号
起動関連	ブートモードをUEFIモードに設定する	[Boot] - [Boot Mode]を[UEFI]に設定してください	ご使用になるOSのインストレーションガイドのセットアップ前の確認事項に従い設定してください
	デバイスの起動順序を変える	[Boot] - [Boot Option Priorities]で起動順序を変更してください	<u>EXPRESSBUILDERを使うときは、CD/DVDを一番高い順位としてください</u>

(2/2)

カテゴリー	ケース	設定内容	備考
起動関連	RTCアラームによるパワーオン機能を使う	[Advanced] - [Advanced Chipset Configuration] - [Wake On RTC Alarm]を[Enabled]に設定してください	
	コンソールリダイレクションを使う	[Advanced] - [Serial Port Configuration] - [Console Redirection Settings]で設定してください	コンソールリダイレクション接続時、端末画面の表示が文字化けする場合は、ご使用端末のフォント設定を、適切な設定に変更してください
	X2APICを有効に設定する	[Advanced] - [Processor Configuration] - [X2APIC]を[Enabled]に設定してください	ご使用になるOSのインストレーションガイドのセットアップ前の確認事項に従い有効／無効を設定してください
セキュリティ	パスワードによって SETUP の操作を制限する	[Security] - [Administrator Password]でパスワードを設定してください [Security] - [User Password]でパスワードを設定してください	パスワードを設定すると、次回SETUP起動時にパスワード入力を促すメッセージが表示されます
	パスワードによってブートを制限する	[Security] - [Password On Boot]を[Enabled]に設定してください	パスワードを設定すると選択できます
UPS 電源連動	UPSから電源を供給されたら常に電源をONにする	[Server] - [Power Control Configuration] - [AC-LINK]を[Power On]に設定してください	
	POWERスイッチを使って電源をOFFしたときは、UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする	[Server] - [Power Control Configuration] - [AC-LINK]を[Last State]に設定してください	
	UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする	[Server] - [Power Control Configuration] - [AC-LINK]を[Stay Off]に設定してください	

3. EXPRESSSCOPE エンジン 3

3.1 概 要

EXPRESSSCOPE エンジン 3 は、システム管理用 LSI であるベースボードマネージメントコントローラー (BMC) を使ってさまざまな機能を実現しています。

EXPRESSSCOPE エンジン 3 の機能については、「EXPRESSSCOPE エンジン 3 ユーザーズガイド」を参照してください。

EXPRESSSCOPE エンジン 3 は、本機の電源ユニット、ファン、温度、電圧などの状態を監視することができます。また、マネージメント専用 LAN をネットワーク接続することにより、Web ブラウザーや SSH クライアントなどを使って遠隔地から次のような制御ができます。

- 本機の管理
- 遠隔地からキーボード、ビデオ、マウス(KVM)の操作(*)
- 遠隔地の CD/DVD、フロッピーディスク、ISO イメージ、USB メモリへアクセス(*)

本機能を実現するために、USB マスストレージデバイス (Remote FD、Remote CD/DVD、Remote USB Memory、Virtual Flash) が仮想的に接続されます。

3.2 EXPRESSSCOPE エンジン 3 のネットワーク設定

以下は、Web ブラウザーから EXPRESSSCOPE エンジン 3 を使うための設定例です。

1. 「1.1.1 POST の流れ」に従って POST を進めます。しばらくすると、次のメッセージが画面左下に表示されます。

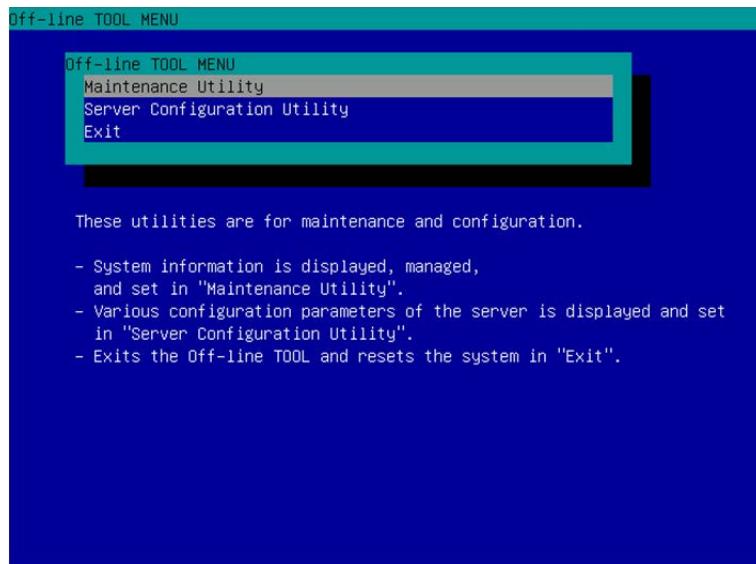
Press <F2> SETUP, <F3> Internal Flash Memory, <F4> ROM Utility, <F12> Network

2. メッセージ表示中に <F4> キーを押して、ROM Utility を起動させます。

NEC ロゴが表示されているときに <F4> キーを押しても Off-line TOOL MENU 画面へ進みます。

3. キーボード選択画面から、使用中のキーボードを選択します。

4. Off-line TOOL MENU から、[Server Configuration Utility]→[EXPRESSSCOPE Engine 3]→[Configuration]→[Network]→[IPv4 Property] または[IPv6 Property]と選択します。



5. 次の画面で、DHCP を使う(DHCP の項目を[Enable]とする)か、または IP Address/Subnet Mask 以下の項目を設定します。



[IPv4 Property]選択時の表示

6. マネージメント専用 LAN コネクタに LAN ケーブルを接続してネットワークにつなげます。手順 5 の設定に従い、管理 PC の Web ブラウザーから EXPRESSSCOPE エンジン 3 へアクセスしてください。

4. EXPRESSBUILDER

「EXPRESSBUILDER」を使うと、OS インストール、本機のメンテナンスなどができます。

4.1 EXPRESSBUILDER が提供する機能

EXPRESSBUILDER は、次のような機能を提供しています。

機能名	説明
バンドルソフトウェアの提供	ESMPRO/ServerAgentService、ESMPRO/ServerAgent など、本機のバンドルソフトウェアを格納しています。
メンテナンス機能	本機をシステム診断できます。この機能を利用するには、ブート後のメニューで「Tool menu」を選択します。
ドキュメントの提供	本書を含む各種説明書を格納しています。

4.2 EXPRESSBUILDER の起動

RAID の構築が必要なときは、次のいずれかの方法により EXPRESSBUILDER を起動します。

標準添付の DVD

メディアをドライブにセットして電源を ON にするか、または<Ctrl>+<Alt>+<Delete>キーで本機を再起動させてください。EXPRESSBUILDER が DVD からブートします。

バンドルソフトウェアのインストールまたはドキュメントを確認したいときは、Windows が起動しているコンピューターへ DVD をセットしてください。自動的にメニューが起動します。

内蔵フラッシュメモリ

POST 時に<F3>キーを押してください。なお、このモードで起動するときは、ドライブからメディアを取り出してください。

5. ソフトウェアのインストール

引き続き、OS など各ソフトウェアをセットアップします。

関連するドキュメントを参照して、指示に従ってください。

6. 電源の OFF

次の順序で電源を OFF にします。本機の電源コードを UPS に接続しているときは、UPS に添付の説明書を参照するか、UPS を制御しているアプリケーションの説明書を参照してください。

1. OS をシャットダウンします。
2. OS をシャットダウン後に本機の電源が OFF になります。
POWER ランプが消灯することを確認します。
3. 周辺機器の電源を OFF にします。

付 錄

1. 仕 様

本機の仕様を記載しています。

2. 割り込みライン

本機の割り込みラインについて説明しています。

3. 用語集

本書の用語集です。

4. 改版履歴

本書の改版履歴です。

I. 仕 様

型名		NE3300-										
		201Y	202Y	203Y	204Y	205Y						
CPU	搭載 CPU	インテル®Xeon®プロセッサー										
		E5-2609 v3	E5-2623 v3	E5-2637 v3	E5-2640 v3	E5-2643 v3						
	動作周波数	1.90GHz	3GHz	3.50GHz	2.60GHz	3.40GHz						
	標準搭載数/最大搭載数	1/2										
	インテル®スマート・キャッシング(ラスト・レベル・キャッシング)	15MB	10MB	15MB	20MB							
チップセット	コア数(C)/スレッド(T) (1CPU)	6C/6T	4C/8T		8C/16T	6C/12T						
	インテル® C612 チップセット											
メモリ	搭載容量 標準/最大	標準搭載なし(セレクタブルオプション) / Registered DIMM : 384GB (24x 16GB), Load Reduced DIMM : 768GB (24x 32GB)										
	搭載メモリ	DDR4-2133 Registered DIMM (4/8/16GB), DDR4-2133 Load Reduced DIMM (32GB)										
	最大動作周波数	1600MHz	1866MHz	2133MHz	1866MHz	2133MHz						
	誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC, メモリックスステップ (x8 SDDC)										
	メモリスペアリング	対応										
補助記憶装置	ハードディスクドライブ	内蔵標準	—									
		内蔵最大	2.5型 HDD: SAS 19.2TB (16x 1.2TB), 2.5型 SSD: SAS 6.4TB (16x 400GB) (オプション HDD ケージ追加時)									
		ホットスワップ	対応									
	インターフェース規格と RAID 構成		SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)									
	光ディスクドライブ		内蔵/外付ドライブ接続 (オプション)*1									
拡張	FDD	オプション: Flash FDD (1.44MB)*2										
		拡張ベイ										
		1x 3.5型拡張ベイ										
	対応スロット		1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (フルハイ、312mm サイズ) (2CPU 構成必須) 2x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (フルハイ、220mm サイズ) (1スロットは 2CPU 構成必須) 3x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (ロープロファイル、220mm サイズ) (2スロットは 2CPU 構成必須) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (RAID コントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (LOM カード専用)									
	グラフィック	搭載チップ/ビデオ RAM	マネージメントコントローラーチップ内蔵 / 32MB									
		グラフィック表示と解像度	1677万色: 640x840、800x600、1,024x768、1,280x1,024									
標準インターフェース		5x USB3.0 (2x 前面、2x 背面、1x 内部), 3x USB2.0 (2x 背面、1x 内部), 2x アナログ RGB (ミニ D-Sub15 ピン, 1x 前面, 1x 背面) 1x シリアルポート (RS-232C 規格準拠/D-Sub9 ピン, シリアルポート A, 1x 背面), 1x マネージメント専用 LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45, 1x 背面) (オプションの LOM カード手配で、4x 1000BASE-T もしくは 2x 10GBASE-SFP+, 2x1000BASE-T を増設可能)										
冗長電源		対応(オプション、ホットプラグ可)										
冗長ファン		対応(標準*5、ホットプラグ可)										
外形寸法(幅 x 奥行き x 高さ)		448.0mm × 734.7mm × 87.2mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含まず) 482.6mm × 776.4mm × 87.5mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含む)										
質量(最小*3/最大)		18.2kg / 32.0kg (レール含む)										
電源		標準搭載なし(セレクタブルオプション), AC 電源ユニット 460W/800W/1000W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) 1000W 80 PLUS® Titanium 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)										
消費電力(100V 最大構成時、25°C高負荷時)		545VA/541W	651VA/646W	684VA/679W	646VA/642W	795VA/790W						
消費電力(100V 最大構成時、最大電力)		746VA/741W	839VA/834W	885VA/879W	817VA/811W	998VA/991W						
省エネ法(2011年度基準)に基づくエネルギー消費効率		対象外	対象外	対象外	対象外	対象外						

型名	NE3300-				
	201Y	202Y	203Y	204Y	205Y
温度/湿度条件	動作時: 10~40°C/20~80%、 保管時: -10~55°C/20~80%(動作時/保管時ともに結露しないこと)				
主な添付品	EXPRESSBUILDER(ESMPRO/ServerManager(Windows 版), ESMPRO/ServerAgent(Linux 版), ユーザーズガイド(電子マニュアル) 含む), スタートアップガイド, 保証書, 「安全にご利用いただくために」, リモートマネジメント拡張ライセンス, ワントップラックレール, フロントベゼル				
無償保障内容	3 年オンライン保守サービス(月～金, 9:00～18:00, 翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等の NEC 指定日を除く) 3 年バーツ保証				
インストール OS	—				
サポート OS	NEC サポート	Red Hat® Enterprise Linux® *4			

*1 内蔵DVD-ROM ドライバを搭載しない場合、保守時およびOS再インストール時に備えて外付けDVD-ROMをオプション購入してください。

*2 必要に応じて購入してください。おもな用途についてはシステム構成ガイドのFlash FDD補足事項を参照してください。

*3 動作可能な最小構成(1x CPU, 2x DIMM, 1x HDD, 1x 電源ユニット, 1x RAIDコントローラー)

*4 Enterprise Linux with Dependable Supportの購入が必要です。Enterprise Linux with Dependable Support利用時はプラットフォームサポートの契約を推奨します。

*5 10~35°C環境において、冗長ファン構成となります。40°C環境で冗長ファン構成を希望される場合は、NE3381-125冗長ファン(拡張用)を手配願います。

型名		NE3300-					
		206Y	207Y	208Y	209Y	210Y	
CPU	搭載 CPU	インテル®Xeon®プロセッサー					
		E5-2660 v3	E5-2667 v3	E5-2690 v3	E5-2697 v3	E5-2699 v3	
	動作周波数	2.60GHz	3.20GHz	2.60GHz	2.60GHz	2.30GHz	
	標準搭載数/最大搭載数	1/2					
	インテル®スマート・キャッシング(ラスト・レベル・キャッシング)	25MB	20MB	30MB	35MB	45MB	
	コア数(C)/スレッド(T) (1CPU)	10C/20T	8C/16T	12C/24T	14C/28T	18C/36T	
チップセット		インテル® C612 チップセット					
メモリ	搭載容量 標準/最大	標準搭載なし(セレクタブルオプション) / Registered DIMM : 384GB (24x 16GB), Load Reduced DIMM : 768GB (24x 32GB)					
	搭載メモリ	DDR4-2133 Registered DIMM (4/8/16GB), DDR4-2133 Load Reduced DIMM (32GB)					
	最大動作周波数	2133MHz					
	誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC, メモリロックステップ (x8 SDDC)					
	メモリスペアリング	対応					
	メモリミラーリング	対応					
補助記憶装置	ハードディスクドライブ	内蔵標準	—				
		内蔵最大	2.5型 HDD: SAS 19.2TB (16x 1.2TB), 2.5型 SSD: SAS 6.4TB (16x 400GB) (オプション HDD ケージ追加時)				
		ホットスワップ	対応				
	インターフェース規格と RAID 構成		SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)				
	光ディスクドライブ		内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1				
	FDD		オプション: Flash FDD (1.44MB) *2				
拡張		拡張ベイ					
		1x 3.5型拡張ベイ					
グラフィック	搭載チップ/ビデオ RAM	1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (フルハイド、312mm サイズ) (2CPU 構成必須)					
	グラフィック表示と解像度	2x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (フルハイド、220mm サイズ) (1スロットは 2CPU 構成必須) 3x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (ロープロファイル、220mm サイズ) (2スロットは 2CPU 構成必須) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (RAID コントローラー専用) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (LOM カード専用)					
標準インターフェース	対応スロット		5x USB3.0 (2x 前面、2x 背面、1x 内部), 3x USB2.0 (2x 背面、1x 内部), 2x アナログ RGB (ミニ D-Sub15 ピン, 1x 前面, 1x 背面) 1x シリアルポート (RS-232C 規格準拠 D-Sub9 ピン, シリアルポート A, 1x 背面), 1x マネージメント専用 LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45, 1x 背面) (オプションの LOM カード手配で、4x 1000BASE-T もしくは 2x 10GBASE-SFP+, 2x1000BASE-T を増設可能)				
	冗長電源		対応(オプション、ホットプラグ可)				
冗長ファン		対応(標準*5、ホットプラグ可)					
外形寸法(幅 x 奥行き x 高さ)		448.0mm × 734.7mm × 87.2mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含まず) 482.6mm × 776.4mm × 87.5mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含む)					
質量(最小*3/最大)		18.2kg / 32.0kg (レール含む)					
電源		標準搭載なし(セレクタブルオプション), AC 電源ユニット 460W/800W/1000W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) 1000W 80 PLUS® Titanium 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)					
消費電力(100V 最大構成時、25°C高負荷時)		714VA/709W	809VA/803W	800VA/794W	836VA/830W	841VA/835W	
消費電力(100V 最大構成時、最大電力)		885VA/879W	994VA/987W	997VA/990W	1004VA/997W	1006VA/999W	
省エネ法(2011 年度基準)に基づくエネルギー消費効率		対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	

型名	NE3300-				
	206Y	207Y	208Y	209Y	210Y
温度/湿度条件	動作時: 10~40°C/20~80%、 保管時: -10~55°C/20~80%(動作時/保管時ともに結露しないこと)				
主な添付品	EXPRESSBUILDER(ESMPRO/ServerManager(Windows 版), ESMPRO/ServerAgent(Linux 版), ユーザーズガイド(電子マニュアル) 含む), スタートアップガイド, 保証書, 「安全にご利用いただくために」, リモートマネジメント拡張ライセンス, ワントッチラックレール, フロントベゼル				
無償保障内容	3 年オンライン保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等の NEC 指定日を除く) 3 年バーツ保証				
インストール OS	-				
サポート OS	NEC サポート	Red Hat® Enterprise Linux® *4			

*1 内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVDSuperMULTIを搭載しない場合、保守時およびOS再インストール時に備えて外付けDVD-ROMをオプション購入してください。

*2 必要に応じて購入してください。おもな用途についてはシステム構成ガイドのFlash FDD補足事項を参照してください。

*3 動作可能な最小構成(1x CPU, 2x DIMM, 1x HDD, 1x 電源ユニット, 1x RAIDコントローラー)

*4 Enterprise Linux with Dependable Supportの購入が必要です。Enterprise Linux with Dependable Support利用時はプラットフォームサポートの契約を推奨します。

*5 10~35°C環境において、冗長ファン構成となります。40°C環境で冗長ファン構成を希望される場合は、NE3381-125冗長ファン(拡張用)を手配願います。

2. 割り込みライン

割り込みラインは、出荷時に次のように割り当てられています。オプションを増設するときなどに参考にしてください。

● 割り込みライン

出荷時では、次のように割り当てられています。

IRQ	周辺機器(コントローラー)	IRQ	周辺機器(コントローラー)
0	システムタイマー	12	SM Bus
1	—	13	数値演算プロセッサー
2	—	14	—
3	COM2シリアルポート	15	—
4	COM1シリアルポート	16	SATA
5	PCI	17	
6	—	18	USB
7	PCI	19	USB
8	リアルタイムクロック	20	
9	Microsoft ACPI-Compliant System	21	
10	PCI	22	
11	マザーボードリソース	23	

3. 用語集

用語	解説
BIOS セットアップユーティリティー (SETUP)	本機のBIOSを設定するためのソフトウェアです。POST時にF2キーを押すと起動できます。
BMC	Baseboard Management Controllerの略で、標準インターフェース仕様のIPMI2.0に準拠してハードウェアを監視するコントローラーです。本機には標準でマザーボード上に組み込まれています。
BMC リセットスイッチ	本機に搭載されたBMCをリセットするスイッチです。BMCの各種設定を引き継いだままBMCのみをリセットします。BMCに問題が起きている場合のみ使用してください。
DUMP スイッチ	何らかの不具合が起きたとき、メモリダンプを採取する場合に使用します。ダンプの保存先については、OS上から指定できます。
ESMPRO	本機に標準添付のサーバー管理ソフトウェアです。監視、管理を行う一連のソフトウェアが含まれます。
ESMPRO/ServerAgent	ESMPRO/ServerManagerと連携し、本機の監視、および各種情報を取得するためのソフトウェアです。OSのサービスとして常駐します。
ESMPRO/ServerAgent Extension	ESMPRO/ServerManagerと連携し、スケジュール運転を実現するためのソフトウェアです。
ESMPRO/ServerManager	ネットワーク上の複数のサーバーの管理、監視を行うソフトウェアです。
EXPRESSBUILDER	本機を簡単にセットアップする機能を持つ標準添付のソフトウェアです。バンドルソフトウェアおよび説明書もEXPRESSBUILDER内に格納されています。
EXPRESSSCOPE エンジン 3	NX7700x/A3010E-2で採用しているBMCの名称です。
EXPRESSSCOPE プロファイルキー	BIOSとBMCの設定を格納したフラッシュメモリです。取り外しが可能になっており、マザーボード交換時、使用中のマザーボードから新規のマザーボードに移設することで設定を引き継ぐことができます。
ExpressUpdate	本機のBIOS、ファームウェア、ドライバー、およびソフトウェアをアップデートする機能です。ESMPRO/ServerManagerが、本機のEXPRESSSCOPEエンジン3、およびExpressUpdate Agentと連携することで本機能を実現します。
ExpressUpdate Agent	ExpressUpdateを実現するために、本機にインストールするソフトウェアです。
Flash FDD	フロッピーディスクドライブと互換性のあるオプションのUSBデバイスです。
OS 標準のインストーラー	Windows、LinuxなどのOSインストール用メディアに標準で格納されているインストーラーです。手動でOSをインストールしたいときに使用します。
RAID コンフィグレーションユーティリティー	RAIDを設定するために、POST時に起動できるソフトウェアです。
Server Configuration Utility	BIOSまたはBMCを設定するためのソフトウェアです。インストールしてOS上から使用するか、POST時にF4キーを押すと起動します。旧モデルでは、BMC Configurationと呼ばれたものです。
Universal RAID Utility	RAIDを設定するために、WindowsまたはLinux上から操作するソフトウェアです。ESMPRO/ServerManagerと連携させて管理PCから操作できます。
エクスプレス通報サービス	本機が故障したときの情報(または予防保守情報)を電子メール、モ뎀経由で保守センターに通報するソフトウェアです。ESMPRO/ServerAgentServiceまたはESMPRO/ServerAgentとともに本機にインストールします。
エクスプレス通報サービス(MG)	ESMPRO/ServerAgentServiceを使わずに、本機が故障したときの情報(または予防保守情報)を電子メール、モ뎀、HTTPS経由で保守センターに通報するソフトウェアです。ESMPRO/ServerManagerとともに管理PCにインストールします。

用語	解説
オフラインツール	IPMI情報(SEL, SDR, FRU)などを確認するためのソフトウェアです。POST時にF4キーを押すと起動します。
管理PC	ネットワーク上から本機にアクセスし、本機を管理するためのコンピューターです。WindowsまたはLinuxがインストールされた一般的なコンピューターを管理PCにすることができます。
内蔵フラッシュメモリ	本機に標準で組み込まれており、EXPRESSBUILDERが格納されているフラッシュメモリです。POST時にF3キーを押すと、メディアが無くても内蔵フラッシュメモリからEXPRESSBUILDERが起動します。
装置情報収集ユーティリティ	本機の各種情報を収集するためのソフトウェアです。保守に必要な情報をまとめて採取できます。

4. 改版履歴

ドキュメント番号	発行年月	改版内容
80.106.01-001.01	2014年11月	新規作成

NEC NX7700x シリーズ

NX7700x/A3010E-2

ユーザーズガイド

2014年 11月

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

TEL (03) 3454-1111 (大代表)

落丁、乱丁はお取り替えいたします

©NEC Corporation 2014

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。